

年報查詢網址：
<https://mops.twse.com.tw>

股票代號：8150

公司年報網址：
<https://www.chipmos.com/chinese/ir/year.aspx>



南茂科技股份有限公司
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.



113年度年報
ANNUAL REPORT

中華民國114年4月15日 刊印

一百一十三年度年報
中華民國一百一十四年四月十五日刊印

本公司發言人

姓名：黃國樑
職稱：策略與投資人關係資深副總經理
電話：(03) 577-0055
E-MAIL : IR@chipmos.com

本公司代理發言人

姓名：蘇郁姣
職稱：財務會計管理中心副總經理
電話：(03) 577-0055
E-MAIL : FIN@chipmos.com

總公司、工廠之地址及電話

新竹總公司(竹科廠)

地址：新竹科學園區新竹縣研發一路1號
電話：(03) 577-0055
傳真：(03) 566-8989

台南廠

地址：南部科學園區臺南市南科七路5號
電話：(06) 505-2388
傳真：(06) 505-2345

台南二廠

地址：南部科學園區臺南市南科七路3號
電話：(06) 505-2388
傳真：(06) 505-2345

竹北廠

地址：新竹縣竹北市新泰路37號
電話：(03) 656-2078
傳真：(03) 553-2715

竹北二廠

地址：新竹縣竹北市中和街112號
電話：(03) 656-2078
傳真：(03) 553-2530

湖口廠

地址：新竹縣湖口鄉仁德路4號
電話：(03) 656-2078
傳真：(03) 598-3012

美國子公司

ChipMOS U.S.A., Inc.

地址：2890 North First Street, San Jose, CA
95134, U.S.A.
電話：002-1-408-922-2777
傳真：002-1-408-922-7275

上海子公司

南茂半導體(上海)有限公司

地址：上海市青浦區蟠中東路58弄25號
404-1室
電話：002-86-21-3328-5177

股務過戶機構

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
地址：臺北市中正區重慶南路一段2號5樓
網址：<https://www.kgi.com.tw>
電話：(02) 2389-2999

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
會計師姓名：林佳鴻、徐建業

地址：臺北市信義區基隆路一段333號27樓
網址：<https://www.pwc.tw>
電話：(02) 2729-6666

海外有價證券掛牌買賣之交易場所

海外存託憑證掛牌交易場所名稱：

美國那斯達克證券交易所

海外存託憑證查詢方式：

<https://www.nasdaq.com>

海外存託憑證證券代號：IMOS

公司網址

<https://www.chipmos.com>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	4
二、董事、總經理及副總經理之酬金	16
三、公司治理運作情形	23
四、簽證會計師公費資訊	64
五、更換會計師資訊	64
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業	65
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權 變動情形	65
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之 資訊	66
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股 數，並合併計算綜合持股比例	67
參、募資情形	
一、資本及股份	68
二、公司債辦理情形	70
三、特別股辦理情形	70
四、海外存託憑證辦理情形	71
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形	71
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	71
七、資金運用計畫執行情形	72
肆、營運概況	
一、業務內容	73
二、市場及產銷概況	82
三、從業員工現況	89
四、環保支出資訊	90
五、勞資關係	90
六、資通安全及智慧財產權管理	91
七、重要契約	93

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析	95
二、財務績效分析	96
三、現金流量分析	96
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	97
五、最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	97
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估	97
七、其他重要事項	102

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料	103
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	103
三、其他必要補充說明事項	103
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	103

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

在產業環境日漸嚴峻與終端需求仍未見復甦的情況下，民國 113 年的營收雖較民國 112 年有所成長，但獲利卻較民國 112 年下滑。然而，南茂科技仍持續秉持審慎、穩健的營運策略，配合產業發展與客戶的需求，持續在核心技術及產品上開發與擴充，以確保未來的營運成長動能與提升獲利。茲將過去一年主要的營運狀況報告如下：

民國 113 年度營業結果

營業計畫實施成果

南茂科技民國 113 年的合併營業額為新台幣 227.0 億元，相較於民國 112 年成長約 6.3%，民國 113 年合併營業毛利率為 13.0%。在個別產品線方面，記憶體產品的營收較民國 112 年成長了 13.9%，佔整體營業額的 37.8%。平面顯示器驅動 IC 相關產品（含金凸塊部份）的營收，與民國 112 年略為持平，佔整體營業額的 52.0%，其中車用面板與 OLED 的營收則在車用與智慧行動裝置滲透率增加的帶動下，分別相較民國 112 年大幅成長了約 16.6% 與 27.7%。

預算執行情形

因應終端需求不振與客戶的庫存去化狀況，除了南科新廠的購置、品質提升與研究發展支出外，嚴格管控相關產能擴充的資本支出。民國 113 年的資本支出為新台幣 54.5 億元。

財務收支與獲利能力分析

南茂科技民國 113 年歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 14.2 億元、基本每股盈餘為新台幣 1.95 元。另外，截至民國 113 年底，南茂科技之合併總資產計新台幣 453.8 億元，其中現金及約當現金計新台幣 152.2 億元，而合併總負債計新台幣 203.1 億元，合併負債比為 44.7%。歸屬於母公司業主之權益為新台幣 250.7 億元，民國 113 年股東權益報酬率為 5.7%。整體而言，南茂科技之財務結構健全。

研究發展狀況

隨著行動裝置的普及，單晶片整合與輕薄短小等趨勢的需求以及 AI 與 5G 等新興運用的崛起等，都不斷地驅動封測業的技術發展。南茂科技為掌握此產業發展的契機，持續投入相關的研究開發，民國 113 年成功開發的重點產品與技術歸類如下：(1) 開發 2P2M 之厚銅佈線 (RDL) 結合高銅柱應用於電源管理晶片封裝需求；(2) 開發 12 吋單機版薄化技術應用於晶圓級晶片尺寸封裝 (WLCSP)；(3) 研發極窄寬度 (<0.42mm) 平面顯示器驅動 IC 於 COF 封裝技術服務；(4) 開發 COF 封裝製程應用於非平面顯示器驅動 IC 之技術服務；(5) 開發第

五代 DDR 同步動態隨機存取記憶體封裝技術；(6) 開發 Thermal enhanced Flip-chip BGA with Heat sink 封裝技術開發。

榮譽與獎項

南茂科技致力於提升公司治理品質以及善盡企業社會責任。同時，結合核心業務永續願景，以具體行動支持聯合國永續發展目標（SDGs）。在環境保護、社會責任與公司治理（ESG）等方面，連續 8 年榮獲 TCSA 台灣企業永續獎之榮譽，獲頒「台灣百大永續典範企業獎」及「企業永續報告—電子資訊製造業-第 1 類白金級」兩大獎項，民國 113 年更首度獲得永續單項獎項「資訊安全領袖獎」、「循環經濟領袖獎」兩大殊榮。同時南茂科技更是封測產業第一家通過國際再循環聲明標準認證，並榮獲「113 年資源循環績優企業-銀質獎」。另外在打造安全友善的幸福職場方面，更是獲得「健康勞動力永續領航企業」典範獎的肯定。

民國 114 年度營業計畫概要

經營方針

持續專注在封測產品技術服務的提升，透過智能輔助、加速智能工廠的推動以有效提高生產效率與提升品質。同時我們也積極實踐企業 ESG 管理與永續發展。另外依據產業景氣狀況、市場趨勢與客戶的需求，以及公司的產能狀況，預計提供各項代工服務如下：

銷售項目	預期銷售數量
封裝	約 22.3 億顆
測試	約 25.7 億顆
平面顯示器驅動 IC	約 13.7 億顆
晶圓凸塊	約 110 萬片

重要產銷政策

為因應日趨嚴峻的國內外市場競爭環境，南茂科技持續專注於利基與高成長的終端運用市場。並持續推動產線的自動化、智慧化等優化的改善作業以提升效率，並持續提高產品的品質與良率。另外也持續開發低材料成本的封裝解決方案，以降低材料成本、提升公司的競爭力，同時也進行如相關的能源耗用管控等節約措施，以進一步降低營運成本。

未來發展策略

展望民國 114 年以及未來，南茂科技仍持續擴展在自動化與智能化趨勢下之車用電子等利基市場與新型智慧行動裝置的高成長市場的成長契機，以掌握產業的發展趨勢以及滿足客戶的需求。另外持續提供尖端的半導體後段全製程技術服務與開發高成長的新產品，以及拓展邏輯與混合訊號產品的營收規模，使公司的營運與獲利可以穩健地持續成長。

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對愈發嚴峻的產業環境與挑戰，我們唯有順應產業發展趨勢、掌握成長契機，並致力於核心技術的研發與創新，以及擴展多元化的產品運用範疇。依據公司的發展策略，配合策略客戶的產品發展藍圖，與客戶一同合作與成長、創造雙贏。同時因應相關溫室氣體排放與綠電等再生能源的法規要求愈趨嚴謹，我們除了積極實踐企業永續發展外，也參與 CDP 碳揭露計畫。同時提升股東價值，則一直是我們努力不懈的目標。最後在此，感謝各位股東長久以來的持續支持。

董事長：



經理人：



會計主管：



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

1. 董事

國籍或註冊地 職稱	姓名	性別 年齡 選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份 股數	現在 持有股數	配偶、未成年子女 現在持有股份 股數	利用他人名義 持有股份 股數	主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管或董事 職稱	姓名 關係	備註		
中華民國 董事長	郭世杰 男 61~70 歲	113.05.30	3年	86.07.17	6,150,161	0.85	6,150,161	0.85	Saginaw Valley State University 企業管理碩士 台灣茂矽電子（股）公司處長 利私科技（股）公司董事長 宏茂微電子（上海）有限公司 董事長	南茂科技（股）公司總經理 ChipMOS U.S.A., Inc.董事 浩祥投資有限公司代表人及 董事 浩衍投資有限公司代表人及 董事	—	—	(註2)	—	—
中華民國 董事	矽品精密工業 (股)公司 法人代表人： 簡申義 男 61~70 歲	113.05.30	3年	86.07.17	78,910,390	10.85	78,910,390	10.85	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	—
中華民國 董事	矽品精密工業 (股)公司 法人代表人： 簡申義 男 61~70 歲	113.05.30	3年	110.07.12	—	—	—	—	東海大學管理碩士 大山電線電纜（股）公司副廠 長	矽品精密工業（股）公司董 事/行政長/資深副總經理 焱元投資（股）公司董事	—	—	—	—	

國籍或註冊地 職稱	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		目前兼任本公司及 其他公司之職務		具配偶或二 親等以下關 係之其他主 管或董事 備註
						股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	不適用	不適用	
中華民國 董事	矽品精密工業(股)公司 中華民國	男 51~60 歲 法人代表人： 張寶心	113.05.30 3年	86.07.17 3年	78910390	1085	78,910,390	1085	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	—
中華民國 董事	蘇郁姍 中華民國	女 51~60 歲	113.05.30 3年	111.11.03 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
獨立董事	湯宇方 中華民國	男 61~70 歲	113.05.30 3年	102.06.17 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(註3)	—

國籍或註冊地 職稱	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期 初次選 任日期	選任時 持有股份 股數	現在 持有股數	配偶、未成年子女 現在持有股份 股數	利用他人名義 持有股份 股數	主要經（學）歷	具配偶或二 親等以下關 係之其他主 管或董事 職稱		備註		
										姓 名	關 係			
中華民國 獨立董事	王永和	男 61~70 歲	113.05.30	3年	96.06.28	—	—	—	國立成功大學電機工程博士 國立成功大學工學院副院長 國立成功大學校友聯絡中心主任 達方電子（股）公司獨立董事/ 審計委員會委員/薪酬委員會委 員 ChipMOS TECHNOLOGIES (Bermuda) LTD. 獨立董事/審 計委員會委員/提名委員會主席/ 全智科技（股）公司獨立董事/ 審計委員會委員/薪酬委員會委 員 財團法人國家實驗研究院院長	國立成功大學電機工程學系主 任 國立成功大學校友聯絡中心主任 財團法人台南市國立成功大 學積電一成大聯合研發中心 主任 詠業科技（股）公司獨立董事 事/審計委員會委員/薪酬委 員會委員	—	—	—	(註4)
中華民國 獨立董事	王志超	男 61~70 歲	113.05.30	3年	113.05.30	—	—	—	國立清華大學材料工程研究所 碩士 國立清華大學材料工程研究所 碩士 群創光電（股）公司董事 長 群創光電（股）公司副廠 長 奇美科技（股）公司副總經理 奇美電子（股）公司總經理 群創光電（股）公司董事長暨 執行長	群創光電（股）公司董事 長 群創光電（股）公司副廠 長 奇美科技（股）公司副總經理 奇美電子（股）公司總經理 群創光電（股）公司董事長暨 執行長	—	—	—	—

國籍或註冊地 職稱	姓名	性別 年齡	選任(就 任日期)	任期 截止 日期	首次選 任日期	選任時 持有股份 股數	現 在 持 有 股 數	配偶、未成年子女 現在持有股份 股數	利 用 他 人 名 義 持 有 股 份	主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務		具配偶或二 親等以內關 係之其他主 管或董事 職稱	姓 名	關 係	備註			
											持股 比率	股數							
獨立董事	楊宏澤	男 61~70 歲	113/05/30	3 年	110/07/12	—	—	—	—	國立清華大學電機系 主任暨 中原大學電機工程學系 主任 中原大學電機研究所所長 蔚華科技（股）公司 審計委員會委員 員	國立成功大學電機系 主任暨電 機研究所所長 財團法人台灣大電力研究試驗 中心董事 國立成功大學能源 科技與策略 研究中心副主任	國立成功大學 電機工程學系 主任暨 中原大學電機工程學系 教授 蔚華科技（股）公司 獨立董事/ 薪酬委員會委 員 國立成功大學電 機研究所所長 財團法人台灣大電力研究試驗 中心董事 國立成功大學能 源科技與策略 研究中心副主 任	國立成功大學 電機工程學系 主任暨 中原大學電機工程學系 特聘教授 事/審計委員會委員 員 國立成功大學 電機工程學系 主任暨電 機研究所所長 財團法人台灣大電力研究試驗 中心董事 國立成功大學能 源科技與策略 研究中心副主 任	國立成功大學 電機工程學系 主任暨 中原大學電機工程學系 特聘教授 事/審計委員會委員 員 國立成功大學 電機工程學系 主任暨電 機研究所所長 財團法人台灣大電力研究試驗 中心董事 國立成功大學能 源科技與策略 研究中心副主 任	國立成功大學 電機工程學系 主任暨 中原大學電機工程學系 特聘教授 事/審計委員會委員 員 國立成功大學 電機工程學系 主任暨電 機研究所所長 財團法人台灣大電力研究試驗 中心董事 國立成功大學能 源科技與策略 研究中心副主 任	國立成功大學 電機工程學系 主任暨 中原大學電機工程學系 特聘教授 事/審計委員會委員 員 國立成功大學 電機工程學系 主任暨電 機研究所所長 財團法人台灣大電力研究試驗 中心董事 國立成功大學能 源科技與策略 研究中心副主 任	—	—	—
獨立董事	林福珍	女 51~60 歲	113/05/30	3 年	113/05/30	—	—	—	—	國立中央大學 財務管理研究所 德勤財務顧問（股）公司 經理 華立企業（股）公司 投資部主 管 長華電材（股）公司 特助	國立中央大學財務管理研究所 德勤財務顧問（股）公司副總 經理 華立企業（股）公司投資部主 管 長華電材（股）公司特助	國立中央大學財務管理研究所 德勤財務顧問（股）公司副總 經理 華立企業（股）公司投資部主 管 長華電材（股）公司特助	國立中央大學財務管理研究所 德勤財務顧問（股）公司副總 經理 華立企業（股）公司投資部主 管 長華電材（股）公司特助	無	—	—	—		

註 1：本公司監察人職權由獨立董事所成立之審計委員會代行之。

註 2：董事長與總經理為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施：

董事長兼任總經理，於務求公司最高治理單位及制定經營決策中心，監督管理階層，依照法令行使職權，對公司及股東負責。

本公司長期致力於深化公司治理及企業永續經營，透過增加獨立董事席次至 5 席及設置功能性委員會，獨立董事為委員會成員，以其獨立性及專業性，提供董事會決策建議，強化董事監督決策品質。本公司過半數董事未兼任本公司員工或經理人。

註 3：102/06/17~110/07/11 曾擔任本公司獨立董事，113/05/30 再次擔任本公司獨立董事。
註 4：96/06/28~102/06/16 曾擔任本公司獨立董事，110/07/12 再次擔任本公司獨立董事。

2. 法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東 名稱	持股比例 (%)
矽品精密工業（股）公司	日月光投資控股（股）公司	100

114年3月29日

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東 名稱	持股比例 (%)
香港商微電子國際公司		
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證		15.500
匯豐商業銀行受託保管價值投資公司投資專戶		7.120
匯豐商銀股份有限公司受託保管卓越資本獲利有限公司專戶		6.003
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣E S G永續高股息ETF證券投資信託基金專戶		2.733
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶		1.570
新制勞工退休基金		1.501
台灣銀行股份有限公司公教保險部		1.422
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總和國際股票指數基金投資專戶		1.107
摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶		1.043
		1.009

114年1月22日

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 3 月 31 日

條件 姓名	專業資格與經驗 (註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
鄭世杰	<ul style="list-style-type: none"> • 企業管理專業 • 同產業公司副董事長 • 同產業上市櫃公司董事長、總經理 	<ul style="list-style-type: none"> • 不適用 	—
簡坤義	<ul style="list-style-type: none"> • 企業管理專業 • 同產業公開發行公司董事、行政長 • 同產業上市櫃公司資深副總經理 	<ul style="list-style-type: none"> • 不適用 	—
張寶心	<ul style="list-style-type: none"> • 電子專業 • 同產業公開發行公司副總經理 • 同產業上市櫃公司資深處長 	<ul style="list-style-type: none"> • 不適用 	—
蘇郁姣	<ul style="list-style-type: none"> • 財務會計專業 • 同產業公司監事 • 同產業上市櫃公司副總經理、財務主管、會計主管、公司治理主管 	<ul style="list-style-type: none"> • 不適用 	—
湯宇方 (獨立董事)	<ul style="list-style-type: none"> • 電機專業 • 同產業上櫃公司董事長、執行長 • 上市櫃公司獨立董事、審計委員會/薪酬委員會成員 	<ul style="list-style-type: none"> • 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之獨立性。 (註 3~6) 	1
王永和 (獨立董事)	<ul style="list-style-type: none"> • 電機工程專業 • 電機科系大學教授 • 同產業上市櫃公司獨立董事、審計委員會/薪酬委員會成員 • 同產業提名委員會成員 	<ul style="list-style-type: none"> • 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之獨立性。 (註 3~6) 	1
王志超 (獨立董事)	<ul style="list-style-type: none"> • 材料工程專業 • 上市公司董事長、執行長 	<ul style="list-style-type: none"> • 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之獨立性。 (註 3~6) 	—
楊宏澤 (獨立董事)	<ul style="list-style-type: none"> • 電機專業 • 電機科系大學教授 • 同產業上市櫃公司獨立董事、審計委員會/薪酬委員會/公司治理委員會/資通安全委員會成員 • 上市櫃公司風險管理委員會/公司治理暨永續經營委員會/併購特別委員會/ESG 執行委員會成員 	<ul style="list-style-type: none"> • 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之獨立性。 (註 3~6) 	2
林福珍 (獨立董事)	<ul style="list-style-type: none"> • 財務會計專業 • 財務顧問公司副總經理 	<ul style="list-style-type: none"> • 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之獨立性。 (註 3~6) 	—

註 1：本公司每位董事皆無「公司法」第 30 條各款情事。

註 2：本公司每位董事皆無「證券交易法」第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

註 3：本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。

註 4：本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）持有公司股份數及比重為 0。

註 5：未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。

註 6：最近 2 年提供本公司及關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0。

5. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化

A. 多元化政策：

依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別及年齡等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

B. 落實多元化情形：

本公司董事會成員具備多元化背景，皆由具豐富產業經營經驗與學術經驗之成員組成，包括企業管理、電機工程、電子、財務會計、材料工程等專業背景。本公司董事會設有 9 席董事，其中包含 5 席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例 56%，並遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估。董事平均任期為 5 年。獨立董事任期年資 3 年以下為 3 席，3 ~9 年為 2 席，全體獨立董事其連續任期不超過三屆。本公司兼任公司經理人之董事為 2 席，佔全體董事比例 22%，不逾董事席次三分之一。

多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
獨立董事席次過半	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成

董事會成員落實多元化情形：

姓名	職稱	性別	兼任本公司員工	年齡（歲）		專業知識與技能						
				51 -60	61 -70	經營管理	風險管理/危機處理	產業知識	領導/決策能力	永續	會計及財務分析	銷售/行銷
鄭世杰	董事長	男	V		V	V	V	V	V	V	V	V
簡坤義	董事	男			V	V	V	V	V	V		
張寶心	董事	男		V		V	V	V	V	V		V
蘇郁姣	董事	女	V	V		V	V	V	V	V	V	
湯宇方	獨立董事	男			V	V	V	V	V	V	V	
王永和	獨立董事	男			V	V	V	V	V	V		
王志超	獨立董事	男			V	V	V	V	V	V	V	
楊宏澤	獨立董事	男			V	V	V	V	V	V		
林福珍	獨立董事	女		V		V	V	V	V		V	

本公司董事會多元化政策及落實情形亦揭露於公司網站。

C. 董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

本公司依據章程設置 9 席董事，現任董事業經民國 113 年 5 月 30 日股東常會選任，其中女性董事 2 席未達三分之一，主因產業結構與特性限制所致。本公司未來配合長遠發展目標及多元化方針，以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，將詢多方管道人才舉薦盡力增加女性董事席次，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

(2) 董事會獨立性

本公司董事會設有 9 席董事，其中包含 5 席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例 56%，且連續任期皆不超過三屆。

本公司獨立董事皆未持有本公司股份。

本公司獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之獨立性。

本公司董事及獨立董事皆無「證券交易法」第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

綜上所述，本公司認為本公司董事會具獨立性。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月29日 (單位：股；%)

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份			利用他人名義 配偶、未成年子女持有股份	主要經營(學)歷	目前兼任 其他公司之 職務	具配偶或 二親等以 內關係人 經理人 職稱	姓名	關係 備註		
					股數	持股 比率	股數								
總經理	中華民國	鄭世杰	男	86.07.17	6,150,161	0.85	—	—	6,244,777	0.86	Saginaw Valley State University 企業管理 碩士 台灣茂矽電子(股)公司處長 利弘科技(股)公司董事長 宏茂微電子(股)有限公司董事長 華特電子工業(股)公司董事長 信茂科技(股)公司董事長 泰林科技(股)公司董事長 紫光宏茂微電子(上海)有限公司副董事長	(註1)	—	—	(註6)
新竹營運製造中心 執行副總經理	中華民國	蔡燈岳	男	101.03.06	262,572	0.04	—	—	820,000	0.11	國立成功大學資源工程所碩士 榮剛重工(股)有限公司 飛利浦建元電子(股)公司 南茂科技(股)公司品質保證中心副總 經理	(註2)	—	—	—
台南營運製造中心 執行副總經理	中華民國	許原豐	男	101.03.06	220,130	0.03	—	—	—	—	國立中山大學電機工程所碩士 國立成功大學助教 飛利浦建元電子(股)公司 南茂科技(股)公司LCDD生產本部副 總經理	無	—	—	—
策略與投資人關係 資深副總經理暨發 言人	中華民國	黃國樑	男	96.04.17	293,223	0.04	—	—	—	—	東吳大學物理系學士 南茂科技(股)公司封裝生產本部副 總經理	(註3)	—	—	—

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份				主要經(學)歷				具配偶或二親等以内關係人之經理人	備註
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		
Driver IC & Mixed-Signal 市場行銷處副總經理	林明誠	男	103.06.01	84,992	0.01	—	—	—	—	—	—	國立清華大學工業工程管理所學士 元智大學工業工程管理所碩士 華新先進電子（股）公司生產管理部經理 南茂科技（股）公司市場行銷處區副總經理	無
財務會計管理中心副總經理	蘇郁姣	女	106.10.01	340,101	0.05	—	—	830,000	0.11	University of Leeds 企業管理碩士 泰林科技（股）公司處長 南茂科技（股）公司資深處長	(註4)	—	—
記憶體暨混合訊號測試生產本部副總經理	劉俊義	男	112.12.01	1,000	—	6,399	—	—	—	中華大學電機工程學系學士 南茂科技（股）公司記憶體設備工程處長	無	—	—
LCDD 生產本部副總經理	陳光輝	男	113.03.01	12,000	—	—	—	—	—	國立成功大學機械工程所碩士 南茂科技（股）公司 LCDD 封裝工程處長	無	—	—
採購資材管理處理	薛閔彰	男	109.11.10	848	—	—	—	—	—	國立台北科技大學工業工程學系學士 南茂科技（股）公司品質保證中心處長	(註5)	—	—
新產品開發管理中心主任資深處長	朱鵬憲	男	109.11.10	—	—	—	—	—	—	國立中央大學電機工程所碩士 南茂科技（股）公司新產品行銷處處長	無	—	—

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份				主要經（學）歷				目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係人之經理人	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			
資訊技術管理中心主任 資深處長	中華民國	許家欣	男	111.04.14	—	—	4,000	—	—	—	—	—	淡江大學機械與機電工程碩士 南茂科技（股）WB系統整合部資深經理 南茂科技（股）公司製造資訊系統處處長	無	—
生產資材管制中心 資深處長	中華民國	郭光庭	男	113.11.05	125,788	—	—	—	—	—	—	—	國立交通大學運輸管理學系學士 南茂科技（股）公司LCDD生產管制處處長	無	—
封裝生產本部 資深處長	中華民國	葉庭彰	男	113.11.05	1,000	—	—	—	—	—	—	—	逢甲大學交通管理科學系學士 南茂科技（股）公司封裝生產本部處長	無	—
晶圓凸塊生產本部 資深處長	中華民國	莊建隆	男	113.11.05	—	—	7,000	—	—	—	—	—	國立中興大學化學工程學系學士 日月光半導體製造（股）公司新產品工程副部經理 南茂科技（股）公司晶圓凸塊生產本部處長	無	—
品質保證中心 處長	中華民國	謝春任	男	113.11.05	—	—	—	—	—	—	—	—	國立交通大學工業管理學系碩士 南茂科技（股）公司晶圓凸塊生產副處長	無	—
稽核室經理	中華民國	鄭淑鈴	女	108.07.12	14,099	—	—	—	—	—	—	—	中華大學財務管理學系學士 茂德科技（股）公司副理 泰林科技（股）公司稽核主管	無	—

註1：ChipMOS U.S.A., Inc.董事、浩祥投資有限公司代表人及董事、浩衍投資有限公司代表人及董事。
 註2：ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD.董事長、南茂半導體（上海）有限公司董事長及總經理、詠祥投資有限公司代表人及董事。

註3：易華電子股份有限公司董事。

註4：ChipMOS U.S.A., Inc.董事長、ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD.董事、南茂半導體（上海）有限公司監事、采富投資有限公司代表人及董事。

註5：RYOWA CO., LTD.董事、晶成能源股份有限公司董事。

註6：總經理與董事長為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施：

董事會乃公司最高治理單位及制定經營決策中心，監督管理階層，依照法令規行使職權，對公司及股東負責。

董事長兼任總經理，於務求公司價值最大化原則，得充分掌握營運資訊及狀況，使經營效率增加、決策執行更順暢。

本公司長期致力於深化公司治理及企業永續經營，透過增加獨立董事席次至5席及設置功能性委員會，獨立董事為委員會成員，以其獨立性及專業性，提供董事會決策建議，強化董事監督決策品質。本公司過半數董事未兼任本公司員工或經理人。

二、董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1. 董事之酬金

職稱 姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				113年度(單位：新台幣仟元；%)				
	報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)	業務費用(D)	薪資、獎費等及特支(E)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益比例	A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益比例	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事長 鄭世杰	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司
董事 簡坤義- 矽品精密	4,930	4,930	—	—	—	—	—	9,592 0.68%	50,418 0.68%	108	108	6,419 —	6,419 —
董事 張寶心- 矽品精密	—	—	4,662	4,662	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事 蘇郁娟	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

職稱	姓名	董事酬金			兼任員工領取相關酬金			A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益比例		
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	薪資、獎金等支薪特支(E)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)	本公司	財務報告內所有公司
獨立董事	湯宇方 (註 5)	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司	本公司
獨立董事	王永和									
獨立董事	王志超 (註 5)									
獨立董事	楊宏澤									
獨立董事	林福珍 (註 5)	13,126	—	—	—	13,126 0.92%	—	—	—	—
獨立董事	歐進士 (註 5)									
獨立董事	溫瓊岸 (註 5)									
獨立董事	詹惠芬 (註 4)									

註 1：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

註 2：請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司訂有董事會績效評估辦法，定期評估董事會及各功能性委員會之績效，且依本公司章程規定，董事之報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準議定；公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不超過 0.5%為董事酬勞。考量獨立董事執行業務之獨立性，本公司獨立董事不參與董事酬勞分派。

註 3：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務（如擔任母公司/轉投資事業非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

註 4：113 年 5 月 25 日獨立董事歐進士先生改選，獨立董事湯宇方女士卸任；獨立董事歐進士先生及林福珍女士新任，其餘董事為連任。

註 5：113 年 5 月 30 日董事全面改選，獨立董事湯宇方先生、王志超先生及溫瓊岸女士新任；獨立董事歐進士先生及林福珍女士新任，其餘董事為連任。

董事酬金級距表

給付本公司 各個董事酬金級距	董事姓名		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)	本公司 財務報告內所有公司		
低於 1,000,000 元	簡坤義-矽品精密 張寶心-矽品精密 湯宇方、王志超 林福珍、歐進士 溫瓊岸、詹惠芬	簡坤義-矽品精密 張寶心-矽品精密 湯宇方、王志超 林福珍、歐進士 溫瓊岸、詹惠芬	簡坤義-矽品精密 張寶心-矽品精密 湯宇方、王志超 林福珍、歐進士 溫瓊岸、詹惠芬	簡坤義-矽品精密 張寶心-矽品精密 湯宇方、王志超 林福珍、歐進士 溫瓊岸、詹惠芬
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	鄭世杰、蘇郁姣 王永和、楊宏澤	鄭世杰、蘇郁姣 王永和、楊宏澤	鄭世杰、蘇郁姣 王永和、楊宏澤	鄭世杰、蘇郁姣 王永和、楊宏澤
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—	—	—
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—	蘇郁姣	蘇郁姣
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	鄭世杰	鄭世杰
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	12 人	12 人	12 人	12 人

註 1：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2. 總經理及副總經理之酬金

113年度（單位：新台幣仟元；%）

職稱	姓名	薪資 (A)	退職退休金 (B)	獎金及 特支費等 (C)	員工酬勞金額 (D)	A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅 後純益之比例			領取來自 子公司以 外轉投資 事業或公 司酬金
						本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	
總經理	鄭世杰	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	本公司
執行副總經理	蔡燈岳								
執行副總經理	許原豐								
資深副總經理暨發言人	黃國樑								
副總經理	林明誠	41,855	41,855	1,355	56,171	11,422	—	110,803	110,803
副總經理	蘇郁姍							7.80%	7.80%
副總經理	劉俊義								
副總經理 (113/03/01 新任)	陳光輝								
資深副總經理 (113/03/01 解任)	陳玉瑛								
副總經理 (113/11/05 解任)	盧東寶								
副總經理 (113/02/07 解任)	李永文								

註 1：本公司總經理及副總經理之薪資參酌同業薪資水準訂定之，獎金之給付則視公司盈餘多寡、個人貢獻及績效表現核定。

註 2：上述退職退休金係屬依勞工法令相關規定之提撥金額。

註 3：員工酬勞為按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。

總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個 總經理及副總經理酬金級距		總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司	
低於 1,000,000 元	李永文	李永文	
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	陳玉瑛	陳玉瑛	
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—	
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	黃國樑、林明誠 蘇郁姍、劉俊義 陳光輝、盧東寶	黃國樑、林明誠 蘇郁姍、劉俊義 陳光輝、盧東寶	
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	蔡燈岳、許原豐	蔡燈岳、許原豐	
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—	
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	鄭世杰	鄭世杰	
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—	
100,000,000 元以上	—	—	
總計	11 人	11 人	

註：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年度（單位：新台幣仟元；%）

	職稱	姓名	股票 金額	現金 金額	總計	總額占稅後純益 之比例（%）
經理人	總經理	鄭世杰	—	18,648	18,648	1.31
	執行副總經理	蔡燈岳				
	執行副總經理	許原豐				
	資深副總經理暨發言人	黃國樑				
	副總經理	林明誠				
	副總經理	蘇郁姣				
	副總經理	劉俊義				
	副總經理（113/03/01 新任）	陳光輝				
	協理	薛閔彰				
	資深處長	朱鵬憲				
	資深處長	許家欣				
	資深處長（113/11/05 新任）	郭光庭				
	資深處長（113/11/05 新任）	葉庭彰				
	資深處長（113/11/05 新任）	莊建隆				
	處長（113/11/05 新任）	謝春任				
	經理	鄭淑鈴				
	資深副總經理 (113/03/01 解任)	陳玉瑛				
	副總經理（113/11/05 解任）	盧東寶				
	副總經理（113/02/07 解任）	李永文				
	資深處長（113/08/31 解任）	楊貴嵐				

(二)酬金總額占稅後純益比例之分析

1. 最近二年支付董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

項目	酬金總額佔稅後純益比例			
	113 年度		112 年度	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	1.60%	1.60%	1.27%	1.27%
總經理及副總經理	7.80%	7.80%	6.40%	6.40%

註：董事、總經理及副總經理酬金提列比例差異係因 113 年稅後純益 1,419,995 仟元，112 年稅後純益 1,893,428 仟元。

2. 紿付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

- (1) 本公司訂有董事會績效評估辦法，定期評估董事會、董事成員及各功能性委員會之績效。給付董事之報酬，乃依公司章程由董事會決議提撥不超過年度獲利的 0.5%為董事酬勞，並依績效評估執行的結果，根據董事對公司營運參與度及貢獻價值，參酌同業水準，訂定合理的薪資報酬。考量獨立董事執行業務之獨立性，本公司獨立董事不參與董事酬勞分派。
- (2) 本公司經理人薪資依職責、專業能力並參考同業水準訂定。整體薪酬由固定薪酬與變動薪酬組成，而變動薪酬訂有「績效獎金計劃」，其核給與財務性及非財務性等績效目標高度連結，以反映職責與工作績效。財務性指標包含營收及獲利等構面，非財務性指標則將永續發展（ESG）、技術研發與創新、客戶服務管理等策略績效目標納入評估。評估範圍包含公司治理、永續能（資）源使用與管理、人才培育、社會參與等各項指標，並視公司經營結果與個人績效表現，核發變動薪酬，藉以強化經理人薪酬與企業績效及股東權益之連結，並鼓勵經理人重視公司的永續發展與長期經營。
員工酬勞係根據公司章程規定，提撥年度獲利的 10%為員工酬勞分派給經理人與員工。
- (3) 綜上所述，本公司酬金制度，考量公司營運狀況、產業趨勢與未來風險等因素，連結永續發展目標，並制定高階主管「績效連結報酬索回政策」，以兼顧公司治理與風險管控。董事及經理人薪資報酬每年皆由薪資報酬委員會審議後提報董事會核准。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近年度董事會開會 8 次 (A)，董事出席列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列席)次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
董事長	鄭世杰	8	—	100.00	
董事	矽品精密工業（股）公司 法人代表人：簡坤義	8	—	100.00	
董事	矽品精密工業（股）公司 法人代表人：張寶心	8	—	100.00	
董事	蘇郁姣	8	—	100.00	
獨立董事	湯宇方（註 2）	4	—	100.00	新任
獨立董事	王永和	8	—	100.00	
獨立董事	王志超（註 2）	4	—	100.00	新任
獨立董事	楊宏澤	8	—	100.00	
獨立董事	林福珍（註 2）	4	—	100.00	新任
獨立董事	歐進士（註 2）	4	—	100.00	舊任
獨立董事	溫瓊岸（註 2）	3	1	75.00	舊任
獨立董事	詹惠芬（註 1）	4	—	100.00	離任

註1：113年5月25日獨立董事詹惠芬女士辭任。

註2：113年5月30日董事全面改選，獨立董事歐進士先生及溫瓊岸女士卸任；獨立董事湯宇方先生、王志超先生及林福珍女士新任，其餘董事為連任。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱年報第 26～29 頁審計委員會運作情形。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

- (一) 第十屆第二十次董事會有關提名一百一十三年度股東常會改選第十一屆董事及獨立董事候選人討論案，董事長鄭世杰先生、董事簡坤義先生、張寶心先生、蘇郁姣女士及獨立董事王永和先生、楊宏澤先生因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經代理主席歐進士獨立董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (二) 第十屆第二十次董事會有關本公司經理人一百一十三年度職位薪資調整建議案，董事長鄭世杰先生及董事蘇郁姣女士因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經代理主席王永和獨立董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (三) 第十屆第二十次董事會有關本公司總經理一百一十二年度績效獎金發放建議案，董事長鄭世杰先生因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經代理主席王永和獨立董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (四) 第十屆第二十次董事會有關本公司執行副總經理及其他經理人一百一十二年度績效獎金發放建議案，董事蘇郁姣女士因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (五) 第十屆第二十次董事會有關本公司總經理一百一十三年度績效目標設定與績效獎金計劃討論案，董事長鄭世杰先生因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經代理主席王永和獨立董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (六) 第十屆第二十次董事會有關本公司執行副總經理及其他經理人一百一十三年度績效目標設定與績效獎金計劃討論案，董事蘇郁姣女士因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (七) 第十屆第二十一次董事會有關本公司一百一十二年董事酬勞分派及發放案，董事長鄭世杰先生及董事簡坤義先生、張寶心先生、蘇郁姣女士因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經代理主席王永和獨立董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (八) 第十一屆第一次董事會有關本公司第二屆提名委員會委員委任案，獨立董事王永和先生、楊宏澤先生及林福珍女士因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (九) 第十一屆第二次董事會有關本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案，獨立董事王永和先生、湯宇方先生及王志超先生因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (十) 第十一屆第三次董事會有關本公司總經理一百一十二年度員工現金酬勞發放金額建議案，董事長鄭世杰先生因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經代理主席王永和獨立董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (十一) 第十一屆第三次董事會有關本公司執行副總經理及其他經理人一百一十二年度員工現金酬勞發放金額建議案，董事蘇郁姣女士因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
- (十二) 第十一屆第三次董事會有關本公司總經理一百一十三年度績效目標設定變更討論案，董事長鄭世杰先生因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經代理主席王永和獨立董事徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

三、董事會自我（或同儕）評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容：

本公司已訂定「董事會績效評估辦法」並經董事會通過，每年對董事會、個別董事成員及功能性委員會（審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會）整體運作進行績效評估。

(一) 內部評估：

評估週期	每年一次				
評估期間	113/01/01~113/12/31				
評估範圍	董事會	個別董事成員	審計委員會	薪資報酬委員會	提名委員會
評估方式	董事成員自評	董事成員自評	審計委員會 成員自評	薪資報酬委員會 成員自評	提名委員會 成員自評
評估內容	一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。	一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。
分數	4.94 分	4.85 分	4.86 分	4.97 分	4.68 分
結果	優	優	優	優	優

註：以【5個等級】進行評量，1分：極差（非常不同意）、2分：差（不同意）、3分：中等（普通）、4分：優（同意）、5分：極優（非常同意）

評估結果：

全年度評估結果於 114 年 2 月提報董事會，並呈送薪資報酬委員會，以作為未來個別董事薪資報酬之參考資料。

(二) 外部評估：本公司依「董事會績效評估辦法」，每三年進行一次外部評估。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每三年一次	113/01/01 ~113/12/31	1.董事會 2.個別董事成員 3.功能性委員會	委請誠一管理顧問股份有限公司 以訪談進行評估	一、董事會組成。 二、對公司營運之參與程度。 三、提升董事會決策品質。 四、內部控制。 五、功能性委員會之運作。 六、企業永續。

彙整各董事自我評估及與董事訪談之結果，誠一顧問公司評估結果為「優良」，說明如下：

- 董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程。
- 董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配。
- 董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會之職能均能有效運作。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- 112 年設置提名委員會。
- 113 年執行董事會外部評估。
- 113 年訂定董事會成員之繼任規劃。

(二) 審計委員會運作情形

1. 本公司已於 96 年 6 月 28 日成立審計委員會，行使公司法、證券交易法及相關法令規定之職權。
2. 審計委員會年度審議工作重點：
 - (1) 監督內部控制之有效實施。
 - (2) 審核重大之資產或衍生性商品交易、資金貸與、背書或提供保證及涉及董事自身利害關係之事項。
 - (3) 簽證會計師之委任、解任、報酬及獨立性與績效評估。
 - (4) 監督及審核公司財務報表之允當表達。
 - (5) 監督公司遵循相關法令及公司存在或潛在風險之管控。
3. 審計委員會成員專業資格與經驗詳年報第 9 頁。
4. 最近年度審計委員會開會 7 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	湯宇方 (註2)	4	—	100.00	新任， 審計委員會召集人
獨立董事	王永和	7	—	100.00	
獨立董事	王志超 (註2)	4	—	100.00	新任
獨立董事	楊宏澤	7	—	100.00	
獨立董事	林福珍 (註2)	4	—	100.00	新任
獨立董事	歐進士 (註2)	3	—	100.00	舊任
獨立董事	溫瓊岸 (註2)	2	1	66.67	舊任
獨立董事	詹惠芬 (註1)	3	—	100.00	離任

註1：113年5月25日獨立董事詹惠芬女士辭任。
 註2：113年5月30日董事全面改選，獨立董事歐進士先生及溫瓊岸女士卸任；獨立董事湯宇方先生、王志超先生及林福珍女士新任，其餘獨立董事為連任。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項

1. 第十屆第十九次董事會（113 年 2 月 22 日）

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會意見之處理
1. 出具一百一十二年度內部控制制度聲明書案。		
2. 一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。	經主席徵詢與會委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通過後，送交董事會決議通過
3. 配合資誠聯合會計師事務所內部輪調變更簽證會計師暨本公司一百一十三年度簽證會計師委任及報酬案。		

2. 第十屆第二十次董事會（113 年 4 月 11 日）

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會意見之處理
1. 本公司 112 年度（西元 2023 年度） Internal Audit Report on Internal Control over Financial Reporting (ICFR) 案。		
2. 本公司 112 年度（西元 2023 年度） Annual Report on Form 20-F (其中包含本公司依國際財務報導準則編製之 112 年度（西元 2023 年度）英文合併財務報告) 案。	經主席徵詢與會委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通過後，送交董事會決議通過

3. 第十屆第二十一次董事會（113 年 5 月 9 日）

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會意見之處理
1. 本公司一百一十三年第一季合併財務報告案。	經主席徵詢與會委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通過後，送交董事會決議通過

4. 第十一屆第三次董事會（113 年 8 月 13 日）

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會意見之處理
1. 本公司一百一十三年第二季合併財務報告案。	經主席徵詢與會委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通過後，送交董事會決議通過

5. 第十一屆第四次董事會（113年11月5日）

議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員會意見之處理
1. 本公司一百一十三年第三季合併財務報告案。	經主席徵詢與會委員全體無異議 照案通過	經審計委員會通過後，送交董事會決議通過
2. 修訂「內部控制制度」案。		

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

本公司113年度審計委員會未有利害關係議案而獨立董事需迴避之情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一) 內部稽核主管每月月底前交付上月份稽核報告及追蹤報告給各獨立董事查閱外，並至少每季於審計委員會陳報及溝通稽核業務。

(二) 會計師至少每季就本公司財務報告查核或核閱之相關事項，以會議的方式向各獨立董事進行報告及溝通。

(三) 113年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通事項如下表：

開會日期	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項
113/02/22	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 112年第4季稽核業務執行情形報告。 ➤ 審核112年度內部控制制度聲明書。 ➤ 112年內部稽核工作進行情況，包含稽核的問題或困難之討論。（單獨會議） 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 112年度查核後之財務報表查核範圍、會計師查核報告、查核之重大性、查核重點、會計師獨立性及112年度會計師提供審計及非審計服務費用總額報告。 ➤ 113年度會計師審計服務公費說明。 ➤ 111年度審計品質指標（AQIs）。 ➤ 112年度財務報表查核工作進行情況，包含查核的問題或困難之討論。（單獨會議）
113/04/11	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 稽核計畫執行情形報告。 ➤ 審核112年度SOX404內控自評結果報告（ICFR）。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 112 Integrated Audit Results。

開會日期	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項
113/05/09	➤ 113年第1季稽核業務執行情形報告。	➤ 113年第1季核閱後之合併財務報表核閱範圍、會計師核閱報告、核閱之重大性、核閱重點報告。 ➤ 113 Integrated Audit Plan。
113/05/30	➤ 稽核計畫執行情形報告。	➤ 無
113/06/11	➤ 稽核計畫執行情形報告。	➤ 無
113/08/13	➤ 113年第2季稽核業務執行情形報告。	➤ 113年第2季核閱後之合併財務報表核閱範圍、會計師核閱報告、核閱之重大性、核閱重點報告。
113/11/05	➤ 113年第3季稽核業務執行情形報告。 ➤ 審核114年度稽核計畫。 ➤ 審核修訂內部控制制度。	➤ 113年第3季核閱後之合併財務報表核閱範圍、會計師核閱報告、核閱之重大性、核閱重點報告。
結果：上述事項各獨立董事皆無意見。		

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V	本公司已訂定「公司治理實務守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範。本公司「公司治理實務守則」揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益	V	(一)本公司設置發言人、代理發言人及服務單位處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並於公司網站設置利害關係人事區，透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要企業永續發展議題。 (二)本公司能掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依相關法令規定，定期揭露主要股東及主要股東最終控制者之資訊。	無差異
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V	(三)本公司已依法令規定於本公司內部控制制度建立相關控管及建立「對子公司監督與管理作業辦法」，本公司亦訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」，定期檢視其管理報表。	無差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V	(四)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「內線交易防制辦法」。本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易，並定期向董事及經理人宣導防範內線交易之相關法	無差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 摘要說明
	是	否	
三、董事會之組成及職責		令。	
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V	(一)本公司董事會多元化政策、具體管理目標及落實情形詳年報第10~11頁並揭露於公司網站。	無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	(二)本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於112年自願設置提名委員會。	無差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名績任之參考？	V	(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」及評估方式，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站，每年以問卷方式進行自我績效評估，且至少每三年將由外部專業獨立機構或外部專家、學者團隊執行評估一次。 董事會績效評估結果，於次一年度第一季結束前完成，並將評估結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名績任之參考。	無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	(四)依據本公司「公司治理實務守則」第29條應每年定期評估簽證會計師獨立性及適任性，且由審計委員會審閱會計師出具之獨立性聲明書及審計品質指標(AQIs)報告外，並依表一之獨立性評估標準與13項AQI指標進行評估。評估後經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議委任，最近一年度評估結果於民國114年2月25日完成。	無差異

評估項目	運作情形		摘要說明 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	V	本公司由財務會計管理中心副總經理蘇郁姣女士擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，職權包含：依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜等。公司治理主管之資格符合本公司「公司治理實務守則」之規定，且每年事業進修時數皆符合法規規範，進修相關資訊請詳表二。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	113 年公司治理相關事務執行重點如下： 1. 召開 8 次董事會、7 次審計委員會及 4 次提名委員會。 2. 召開股東常會 1 次。 3. 董事每年進修時數皆符合法規規範，相關資訊請詳表二。 4. 本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。	無差異
		本公司重視各類利害關係人，透過公司網站、內外部信箱、社群平台等溝通管道，瞭解其關注議題與需求；此外，本公司網站設置利害關係人事區，亦提供公司發言人及相關業務之聯絡資訊，以妥適回應利害關係人所關切之重要企業永續發展議題。	本公司於 113 年 8 月 13 日彙整利害關係人溝通情形向董事會報告，詳見公司網站（ https://www.chipmos.com/chinese/csr/editor.aspx?CCID=67 ）。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	
六、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司委任凱基證券股份有限公司代辦本公司股東會事務。	無差異
七、資訊公開	V	(一)本公司已架設中英文網站（www.chipmos.com），主動揭露財務、業務及公司治理等相關資訊，並可在公開資訊觀測站查詢相關資訊。 (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	無差異
(一)公司是否架設網站，揭露財務、業務及公司治理資訊？	V	(二)本公司已架設中英文網站；本公司設有發言人及代理人發言人各一人；本公司責成財務會計管理中心、策略與投資人關係相關單位負責公司資訊（含法人說明會資訊、網路廣播與影音重播）揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V	(三)本公司已在會計年度結束後兩個月內公告並申報經會計師查核簽證之年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？	無差異
	V	1. 員工權益、僱員關懷：本公司確實落實勞動基準法等相關規定，定期辦理教育訓練，成立職工福利委員會，以保障員工權益。 2. 投資者關係：本公司設有發言人及代理人發言人各一人，及策略與投資人關係單位，處理投資者提出之建議與疑義。 3. 供應商關係：本公司秉持誠信原則維繫與供應商之關係，針對主要進貨供應商進行營運及財務狀況評估，以確保進貨供應之穩定性，並與供應商建立良好之合作關係，同時	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 摘要說明
	是	否	
		開發其他可能替代之材料與廠商，以增加進貨來源之彈性。	無差異
V	V	4. 利害關係人之權利：本公司建立各部門機能，與利害關係人包括股東、員工、客戶、供應商、政府機關、社區團體等，保持暢通之溝通管道。	無差異
V	V	5. 董事進修之情形：董事每年進修時數皆符合法規規範，相關資訊請詳表二。	無差異
V	V	6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已訂定「風險管理政策與程序」，以穩健經營為原則，遵循政府法令規章，並由內部稽核單位查核以降低可能面臨之風險，且於 113 年 8 月 13 日向董事會報告運作情形。	無差異
V	V	7. 客戶政策之執行情形：本公司於商業往來之前，考量客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信之行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。生產高品質產品滿足客戶質與量的需求，與客戶維持良好長期的關係。	無差異
V	V	8. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。	無差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：			
本公司第十屆（受評年度 112 年）公司治理評鑑結果名列 6—20%之上上市公司。			
113 年有下列加強事項與措施：			
1. 揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策。			

評估項目	運作情形		摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否		
2. 公司編製之永續報告書經董事會決議通過。				
3. 修訂並揭露「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。				
4. 提早揭露前一年度審委會運作情形及獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形。				
本公司將針對尚未達成項目，持續評估考量可能改善之方案，並持續強化公司治理效能。				

表一：
會計師獨立性評估標準：

項目	具體指標	評估結果 (是/否)	是否符合獨立性 (是/否)
1	會計師是否與本集團有直接或重大間接財務利害關係。	否	是
2	會計師及所有審計服務小組成員，是否持有本集團之股份。	否	是
3	會計師是否與本集團有密切之商業關係及潛在雇用關係。	否	是
4	會計師及其審計小組成員目前或最近兩年是否有在本集團擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	否	是
5	會計師是否有對本集團提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
6	會計師是否有仲介本集團所發行之股票或其他證券。	否	是
7	會計師是否有擔任本集團之辯護人或代表本集團協調與其他第三人間發生的衝突。	否	是
8	會計師是否與本集團之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是
9	會計師任期是否連續超過五年。	否	是
10	簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否有擔任本集團董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	否	是
11	非審計服務公費是否超過近3年平均審計公費之70%。	否	是

表二：
113 年董事進修情形：

姓名	職稱	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
鄭世杰 董事長	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3	
	113/10/15	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露及綠電趨勢	3	
簡坤義 董事	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3	
	113/11/15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
張寶心 董事	113/05/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3	
	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3	
蘇郁姍 董事	113/10/15	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露及綠電趨勢	3	
	113/05/17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6	
湯宇方 獨立董事	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3	
	113/10/15	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露及綠電趨勢	3	
湯宇方 獨立董事	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3	
	113/10/15	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露及綠電趨勢	3	

姓名	職稱	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
王永和 獨立董事		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3
		113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113/10/15	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露及綠電趨勢	3
王志超 獨立董事		113/07/30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	出口管制對企業營運的影響及其風險管理管控	3
		113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3
		113/10/29	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會應考量之 ESG 相關法律議題	3
		113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3
楊宏澤 獨立董事		113/08/27	社團法人中華公司治理協會	外資企業在台董監責任及公司治理應留意事項	3
		113/08/28	社團法人中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3
		113/10/15	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露及綠電趨勢	3
		113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
林福珍 獨立董事		113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3
		113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3

姓名	職稱	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
	113/10/15	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露及綠電趨勢		3
	113/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明 會		3

113 年公司治理主管進修情形：

姓名	職稱	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
蘇郁姍 公司治理主管		113/05/17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6
		113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3
		113/10/15	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露及綠電趨勢	3

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

114年3月31日

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗 (註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人/ 独立董事	王永和	<ul style="list-style-type: none"> • 電機工程專業 • 電機科系大學教授（五年以上經驗） • 同產業上市櫃公司獨立董事、審計委員會/薪酬委員會成員 • 同產業提名委員會成員 	<ul style="list-style-type: none"> • 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之獨立性。 (註 2~5) 	1
委員/ 独立董事	湯宇方	<ul style="list-style-type: none"> • 電機專業 • 同產業上櫃公司董事長、執行長 • 上市櫃公司獨立董事、審計委員會/薪酬委員會成員 	<ul style="list-style-type: none"> • 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之獨立性。 (註 2~5) 	1
委員/ 独立董事	王志超	<ul style="list-style-type: none"> • 材料工程專業 • 上市公司董事長、執行長 	<ul style="list-style-type: none"> • 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條之獨立性。 (註 2~5) 	—

註 1：本公司每位董事皆無「公司法」第 30 條各款情事。

註 2：本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司及關係企業之董事、監察人或受僱人。

註 3：本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）持有公司股份數及比重為 0。

註 4：未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。

註 5：最近 2 年提供本公司及關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 薪資報酬委員會設置目的如下：

A. 訂定並定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(2) 本公司之薪資報酬委員會成員計三人，皆為獨立董事。

(3) 本屆委員任期：113年6月11日至116年5月29日，最近年度薪資報酬委員會開會6次（A），委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	王永和	6	—	100.00	薪資報酬委員會召集人
獨立董事	湯宇方（註）	3	—	100.00	新任
獨立董事	王志超（註）	3	—	100.00	新任
獨立董事	歐進士（註）	3	—	100.00	舊任
獨立董事	溫瓊岸（註）	2	1	66.67	舊任

註：113年5月30日董事全面改選，獨立董事歐進士先生及溫瓊岸女士卸任；獨立董事湯宇方先生及王志超先生新任，其餘獨立董事為連任。113年6月11日經本公司董事會決議委任本屆薪資報酬委員會委員。

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理（如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因）：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、最近年度開會日期、期別、議案內容、決議結果：

薪酬委員會會期		薪資報酬委員會			公司對薪資報酬委員會意見之處理
日期	期別	序號	議案內容	決議結果	
113/02/22	第五屆 第十五次	1	一百一十二年度董事會績效評估結果報告案。	不適用	不適用
		2	一百一十二年度員工及董監酬勞分派討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
		3	本公司經理人異動暨接任人薪酬核敘討論案。		
113/04/11	第五屆 第十六次	1	本公司經理人一百一十三年度職位薪資調整討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
		2	本公司經理人一百一十二年度績效獎金發放討論案。		
		3	本公司經理人一百一十三年度績效目標設定與績效獎金計劃討論案。		
113/05/09	第五屆 第十七次	1	本公司董事會及功能性委員會出席費討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
		2	本公司一百一十二年董事酬勞分派及發放討論案。		
113/06/11	第六屆 第一次	1	推舉第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
113/08/13	第六屆 第二次	1	本公司經理人一百一十二年度員工現金酬勞發放金額討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過
		2	本公司經理人一百一十三年度績效目標設定變更討論案。		
113/11/05	第六屆 第三次	1	本公司經理人異動暨接任人薪酬核敘討論案。	全體出席委員同意通過	經薪資報酬委員會通過後，送交董事會決議通過

3. 提名委員會成員資料及運作情形資訊

(1) 敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：由董事會推舉至少三名董事組成之，其中過半數成員應為獨立董事。本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- A. 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
- B. 建構及發展董事會及各功能性委員會之組織架構。
- C. 訂定並定期檢討董事之繼任計畫。

(2) 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形

- A. 本公司之提名委員會委員計三人，皆為獨立董事。
- B. 本屆委員任期：113年5月30日至116年5月29日，最近年度提名委員會開會4次（A），委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格 與經驗	實際出席次 數 (B)	委託出 席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	王永和	詳年報 第9頁	4	—	100.00	提名委員會召集人
獨立董事	楊宏澤		4	—	100.00	
獨立董事	林福珍（註2）		2	—	100.00	新任
獨立董事	詹惠芬（註1）	不適用	2	—	100.00	離任

註1：113年5月25日獨立董事詹惠芬女士辭任。

註2：113年5月30日董事全面改選，獨立董事林福珍女士新任，其餘獨立董事為連任。

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

日期	期別	序號	議案內容	成員建議或反對事項內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
113/02/22	第一屆 第二次	1	獨立董事之獨立性情形報告案。	無	不適用	不適用
		2	一百一十三年度股東常會改選第十一屆董事（含獨立董事）案。		經主席徵詢與會委員全體無異議照案通過	
113/04/11	第一屆 第三次	1	訂定「董事會成員之繼任規劃」案。	無	經主席徵詢與會委員全體無異議照案通過	不適用
		2	提名一百一十三年度股東常會改選第十一屆董事之獨立董事候選人討論案。			
113/05/30	第二屆 第一次	1	推選提名委員會召集人案。	無	經與會委員推舉王永和獨立董事擔任召集人，全體與會委員一致無異議照案通過	不適用
113/06/11	第二屆 第二次	1	本公司第六屆薪資報酬委員會成員人選建議案。	無	獨立董事王永和先生因本案涉及個人利害關係依公司法規定迴避，經代理主席楊宏澤獨立董事徵詢其餘出席委員無異議照案通過	不適用

(五) 推動永續發展執行情形及與上市公司永續發展實務守則差異情形及原因；上市上櫃公司氣候相關資訊
1. 推動永續發展執行情形及與上市公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	遵循本公司永續政策之願景與使命，本公司設置「永續發展委員會」，為組織內部最高層級永續管理組織，由董事長兼總經理擔任主席與最高指揮主管，執行副總經理為南北廠區最高管理階層，主要成員為各業務單位之高階主管，共同依據公司營運策略，訂定永續發展目標，於日常業務中落實永續計畫。	本公司設置「企業社會責任規劃部」作為推動永續發展及委員會運作之專職單位，負責制定政策、制度及永續發展推動計畫之提出與執行；委員會每年至少召開1次會議，檢討永續目標之進展與成果，及透過每年彙編永續報告書，說明永續管理行動與推動績效。	尚無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之	V	「永續發展委員會」每季向董事會報告永續專案之執行狀況與成果，議題包含：永續發展之淨零排放推動（含溫室氣體盤查及查證）、年度永續發展成果（含利害關係人溝通情形）、永續發展中長期目標計畫、風險管理等執行成果。最近一次報告日期為113年11月5日。	本公司董事會持續落實監督公司永續發展規劃與執行，協助經營團隊實踐企業永續發展，持續推升永續績效。詳細資訊請參考本公司網站及永續報告書。	尚無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	摘要說明	
風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？			係人包容性)，系統性地進行重大主題分析三大流程：鑑別、分析及確認，經辨識後本公司 112 年共 8 項重大主題，並於公司網站及永續報告書內回應其管理方針（包含但不限於訂定相關風險管理政策或策略），而 113 年辨識結果將於 114 年 8 月公告。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		<p>(一) 本公司為提升環境管理水準，善盡企業公民責任，自成立即通過 ISO 14001 環境管理系統驗證，並配合客戶需推動 QC-080000 有害物質流管理系統驗證，在環境友善方面全面推展環保相關系統查驗證，包含 ISO 14064-1 溫室氣體盤查、ISO 14067 破足跡、ISO 14046 水足跡、ISO 50001 能源管理系統、ISO 14051 物質流成本會計，以符合國際趨勢及客戶之要求。於生產過程中所衍生空汙處理、廢水處理、廢棄物處理，除了取得相關許可證件依其要求操作外，更積極採取許多措施追求永續環保，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 推動環境政策：持續教育員工並透過公司網站傳達，承諾廢氣廢水廢棄物汙染預防及用水用電減量管制之企圖心。 空汙排放減量：在空氣品質方面以提高防制設備處理效率來降低空氣汙染排放量為目標，如增設沸石轉輪及 RTO 之高效能空汙防制處理，削減率大於 90%。 用水/廢水減量與回收：持續提升廠內製程廢水回收 	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	
		率，符合轄區管制大於 85%，並將冷凝水及雨水回收至冷卻水塔及公共用水使用。	4. 廢棄物再利用：推動製程源頭管理原物料最佳化使用及廢棄物由焚化/掩埋轉再利用，再利用率大於 35%。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	(二) 本公司對於電力、水資源、材料之使用、再利用與回收，均有建立管理制度，並持續推動源頭管理與節能減廢，廠內已成立節能小組，積極針對各項耗能設備與節能減碳管理方案，每年除符合能源署的 1% 能能要求外，亦汰換老舊設備及調整控制參數，提升能源使用效率。在製造過程中對供應設施效率提升及規格調整之要求，以「節能」、「減量」為目標，如空調節能、節能照明（LED）的安裝、無塵室循環風機（FFU）效率提升、製程節能及減廢流程改善、太陽能綠能發電、切割研磨廢水及雨水回收的推動。於能源使用效率面，已獲通過能能源管理、物質流成本會計查驗證及綠建築、綠色工廠之標章，以期降低環境衝擊之負荷，朝向循環經濟及零汙染邁進；於再生物料面，本公司持續精進生產製程，致力於源頭改善，減少使用浪費，並將可再使用的包裝材料回收循環再利用，本公司可再使用之包裝材料回收再利用率於 113 年皆超過 90%。	上述提升能源使用效率及使用再生物料之相關績效請參考公司網站（113 年績效將於 114 年 8 月公告）。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V	(三) 本公司在氣候變遷議題，於 110 年開始展開 TCFD 導八作業，並列出重大風險機會矩陣及採取相關因應措施，已於 113 年填答 CDP 問卷資料，提供相關投資者參考，且致力於降低溫室氣體排放，本公司盤查碳排放約有 98%來自於電力，故導入 ISO 50001 能源管理系統，並致力於降低碳排放，且致力於再生能源設置，並依再生能源條例規劃於 114 年完成再生能源使用量達義務量 10%。	尚無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	(四) 本公司所有廠區 113 年已完成 ISO 14064-1 範疇一至範疇三查證，同時為持續達成減量趨勢、回應客戶及符合對低碳產品的期待，亦訂有環境政策及能源相關政策，關注氣候變遷對營運活動之影響，相關績效可再查閱本公司永續報告書及公司網站。	尚無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明																		
	是	否	摘要說明																			
			<p>(1) 最近兩年溫室氣體排放量及其管理政策：請參閱下表 2. 上市上櫃公司氣候相關資訊。</p> <p>(2) 最近兩年用水量及其管理政策：</p> <table border="1" data-bbox="436 550 817 1246"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">112 年</th> </tr> <tr> <th>113 年</th> <th>112 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總用水量 (百萬公升)(A)</td> <td>1,611.852</td> <td>1,608.700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>營收淨額 (百萬元)(B)</td> <td>22,695.909</td> <td>21,356.228</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用水使用效率 (A) / (B)</td> <td>0.0710</td> <td>0.0753</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	年度	112 年		113 年	112 年	總用水量 (百萬公升)(A)	1,611.852	1,608.700		營收淨額 (百萬元)(B)	22,695.909	21,356.228		用水使用效率 (A) / (B)	0.0710	0.0753		<p>本公司已於 109 年建置製程回收水設備 (2,700CMD)，每年新增回收水水量約為 837.2 百萬公升，111 年新增製程回收水設備 (550CMD)，每年新增回收水水量約為 137 百萬公升，112 年亦建置製程回收水設備，預估每年新增回收水水量為 122.02 百萬公升，全廠回收水量將有效提升用水使用效率。</p>
項目	年度	112 年																				
		113 年	112 年																			
總用水量 (百萬公升)(A)	1,611.852	1,608.700																				
營收淨額 (百萬元)(B)	22,695.909	21,356.228																				
用水使用效率 (A) / (B)	0.0710	0.0753																				

推動項目	是 否	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明	
		項目	年度	113 年	112 年	
(3) 最近兩年廢棄物總重量及其管理政策：						
		非有害廢棄物 (公噸)(A)	1,741	1,741	1,520	
		有害廢棄物 (公噸)(B)	892	892	717	
		營收淨額 (百萬元)(C)	22,695.909	22,695.909	21,356.228	
		非有害強度 (A)/(C)	0.0767	0.0767	0.0712	
		有害強度 (B)/(C)	0.0393	0.0393	0.0336	
本公司為達永續資源再利用，廢棄物優先採用廠內再使用，減少原物料使用，其次採再利用/回收，最後採行焚化處理。						
四、社會議題						
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約， 制定相關之管理政策與程序？						V
(一)本公司遵守當地勞動法規，並根據「責任商業聯盟行為準則（Responsible Business Alliance, RBA）」之國際勞工及人權標準，融合人性化管理，制定書面員工政策，並公告於公司人事佈告欄，俾使員工能查詢了解並遵行。人力資源管理中心也會隨時掌握勞動法令修改的情形，適時調整管理制度，讓所有員工的勞動權益獲得保障。						尚無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將績效或成果適當反映於員工薪酬？	V	本公司已制定保障人權之政策與具體方案，完整公告於公司網站。	(二)本公司訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），相關施行辦法均設有人事規章可遵循。本公司員工採行職務職等制度，依據任職務、學經歷、專業年資與個人工作績效訂定薪資報酬。每年參與薪資調查以瞭解市場薪資水準，確保本公司之薪酬於業界具有競爭力，並依營運狀況及員工績效表現定期進行調薪。為幫助員工累積退休資產，於112年實施「員工持股信託計畫」，鼓勵員工持有公司股票共享公司之經營成果。本公司亦於公司章程內明定公司年度如有獲利，提撥10%為員工酬勞分派給經理人及員工，以確實將經營績效適當反映於員工薪酬。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三)本公司為維護員工之安全衛生除訂有政策之外，並推動ISO 45001職業安全衛生管理系統，在職業安全衛生管理方面，注重「職場安全」與「勞工健康」並積極推動電氣防爆區域劃分與風險低減、化學品暴露危害風險評估與分級管理、人因工程等，透過適當的設計、工程和行政管制、防護保養和安全操作程序及安全知識培訓來降低、消除及預防工作場所的危害風險，並透過實施緊急應變程序落實訓練演練將財產與傷害之影響降到最低，每年訂定職業安全衛生計劃，並依計畫實施教育訓練及作業環境監測，且免費提供在職員工健康檢查，舉辦健

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	
			<p>康促進活動，獲科技部科學園區管理局及國民健康署頒贈「職業安全衛生優良單位」、「健康職場自主認證標準」及減重績效團體及個人獎項，成功打造安全健康的職業環境。</p> <p>113 年本公司員工發生的職業傷害事件共 8 件，人數 8 人（佔 113 年員工總人數 0.1%），失能傷害頻率（FR）為 0.67、失能傷害嚴重率（SR）為 12、失能傷害綜合指標（FSI）為 0.09，優於其他電子零組件製造業，顯示本公司安全管理績效之成果。113 年本公司發生的火災事件共 0 件。</p> <p>為更加提升安全管理成效，本公司朝全員參與方向規畫，包括程序文件審查、作業環境監測之參與、會同事件調查及危害鑑別等，並建置包含溝通意見的管理系統。員工可透過電話、電子郵件及各類會議等管道，反應相關職安衛意見、進行溝通諮詢，或向職安衛勞工代表提出意見，並於各廠區環境安全衛生暨能源管理委員會提出並討論。廠內相關職安衛法令及規範溝通或傳達，可於公司電子公佈欄查詢，或參閱廠內發行刊物、教育訓練或公告等方式獲得資訊。</p> <p>本公司每年訂定教育訓練計劃，並依工作者性質分別進行訓練，113 年度共 12,346 人次參訓，訓練時數 31,584 小時，包含一般安全衛生教育訓練、自衛消防編組暨民防團訓練、人因工程危害預防、急救人員訓練、環境教</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	<p>育訓練、交通安全宣導、化學品防護具穿戴教育訓練等。承攬商之職業安全衛生教育訓練，另依承攬商安全衛生環保管理辦法辦理，落實職安衛教育訓練，提升工作者安全衛生意識。</p> <p>此外，推動優良職安衛單位及人員表揚等活動，促進各單位參與，鼓勵員工對於環境安全衛生及能源之提案，期望藉由廠內提案獎勵制度，鼓勵同仁對日常業務及環境積極提出改善建議，以達預防災害發生。</p>	<p>尚無重大差異</p>
			<p>(四)本公司提供完整的六大類別課程，讓每位員工在不同階段皆有全面性的培訓機會，並提供員工自行參與外訓課程的補助。豐富多元的內外資源，讓員工職涯有自我成長的機會。多元學習的方式，員工隨時隨地都可經由各種管道進行學習，113 年度共計 5,915 名員工參與教育訓練，總時數為 955,159.10 小時，分別為主管人員 47,463.23 小時；技術人員 373,861.52 小時；行政人員 43,494.60 小時；作業員 490,339.75 小時。</p> <p>1. 新人訓：增進強化對於公司產品組織、經營方向與核心價值的瞭解及認同。</p> <p>2. 工程技術：因應策略方向規劃工程技術類課程以奠定專業基石並提升知能；建立南茂工程師專業學程 (BU 學程)，以工程師專業能力養成為概念，量身打造系統化的培訓課程，並且促進知識經驗的有效傳承。</p> <p>3. 品質管理：促進公司品質系統之推展。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	
(五) 對產品與服務之顧客健 康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V	<p>4. 環安工衛：落實員工工具備合格之證照與具備正確工作環境安全相關知識。</p> <p>5. 領導管理：以公司年度營運策略方向及各階主管所具备之職能為依據，強化領導梯隊之管理能力。</p> <p>6. 工作效能：提供員工於工作上所需之相關技能培訓，使其於工作上得以充分應用所學。</p>	<p>(五)1. 公司的產品和服務符合有關客戶健康和安全、隱私、銷售、標籤的相關法規和國際規則，且本公司已通過多項國際標準，包括 IATF 16949、ISO 9001、QC 080000、ISO 14001、ISO 50001、ISO 17025、ISO 27001、ISO 45001、ANS/ESD S20.20 和 ISO 26262，並保持每年維護證書有效期，於本公司網站內已公開最新證書。 https://www.chipmos.com/chinese/about/detail.aspx?AID=9)</p> <p>2. 本公司與外部利害關係者（客戶、供應商）之因商務機密資料往來需求，會透過資訊保密合約（NDA）簽訂確保雙方權益。</p> <p>3. 依據品質政策，本公司積極滿足客戶對產品品質、良率、技術、交期、服務要求與滿意度監控，透過「客戶服務管理程序書」來使相關單位遵循建立溝通管道。針對客訴事件會透過「客戶退貨訴怨處理程序書」實施即時異常處理作業流程，確保維護客戶權益。</p> <p>4. 本公司為半導體封裝、測試代工廠，並無直接提供最</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因摘要說明
	是	否	終產品供給消費者，無產品與服務之標示問題。	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六)本公司於評估新供應商時，即遵循 RBA 宗旨及相關準則規定，調查其是否有秉持環境保護、職業安全衛生與企業責任之理念，善盡企業公民之責，以及過去有無影響環境、職業安全衛生與社會之紀錄，若有相關記錄者便會要求其提出報告及改善結果，並確認目前實際執行狀況。 本公司亦訂定「供應商管理辦法」並依據辦法每年制定稽核計畫，對供應商逐項稽核審查。供應商稽核結果之詳細資訊請參考本公司網站及永續報告書。	尚無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司 112 年永續報告書遵循 GRI 永續性報導準則 (GRI Standards)、永續會計準則委員會 (SASB) 之半導體業準則，及氣候變遷財務揭露框架 (TCFD) 進行編撰。為確保資訊揭露品質，報告書已於 113 年 5 月 29 日通過英國標準協會 (BSI Taiwan) 查證，並符合 GRI 準則及 AA1000 AS v3 TYPE II 高度保證與 SASB TYPE I 中度保證等級，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 (https://www.chipmos.com/chinese/csr/report.aspx)	尚無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司訂定「永續發展實務守則」，於 102 年 8 月 13 日經董事會決議通過實施，並於 112 年 5 月 4 日經董事會決議通過第四次修訂，其實際運作與「永續發展實務守則」無重大差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				本公司各類永續發展運作情形，請參考本公司網站 (https://www.chipmos.com/chinese/csr/news.aspx) 及永續報告書。

2. 上市上櫃公司氣候相關資訊
2-1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p> <p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。</p> <p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p> <p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p> <p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p> <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>1. 本公司重視與關注氣候變遷議題，提高氣候治理層級，由董事會定期監督環境管理進程，在氣候變遷管理上，針對氣候變遷、水資源及自然環境的風險機會進行衝擊評估，並制定相關因應策略。</p> <p>2. 本公司依風險衝擊可能發生時間（短期、中期、長期）、衝擊程度因子（財務、營運/人力、法令、商譽），排序出風險與機會等級，最終鑑別出4項重大碳風險及3項重大碳機會，其對企業造成之業務、策略及財務影響，詳見本公司永續報告書。</p> <p>3. 一旦發生高溫、極端降雨以及降雨不均等氣候災害，本公司的營運即處於中風險之狀態，該衝擊的程度將隨著本公司的能源轉型行動和水資源回收利用的發展，而逐漸降低，轉型行動對財務之影響包含：資本支出增加、直接成本增加、間接成本增加、營業收入降低、公司營運失能等。</p> <p>4. 本公司把氣候相關風險納入企業風險管理（Enterprise Risk Management，ERM）的框架中，每年審查全公司直接運營等風險問題，範疇包含營運風險、氣候變遷風險、資訊安全風險、財務風險、供應鏈風險、法遵風險，透過量化評估定義風險控管的優先順序與風險等級，並依其風險等級採取相對應的風險管理策略，進而推動公司穩健經營與永續發展。</p> <p>5. 本公司採用「轉型風險情境分析」及「實體風險情境分析」，模擬各種參數變化，所使用之參數、假設、分析因子及主要財務影響，詳見本公司氣候與自然環境報告書。</p> <p>6. 辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標，詳見本公司氣候與自然環境報告書。</p> <p>7. 考量內部調節成本、內/外部碳成本、再生能源投資和綠色電力採購等因素，本公司每年更新內部碳定價以應用於能效投資評估，計算公式如下：T-REC 購買綠電憑證</p>

項目	執行情形
<p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證（RECs）數量。</p>	<p>費用（TWD 6,000 元/MWh）一台電外購電力費用（TWD 3,680 元/MWh）/電力排碳係數（0.495）=（TWD 2,320 元/MWh）/0.495 噸 CO2e=TWD 4,686 元/噸 CO2e。</p> <p>8. 本公司規劃以 139 年（西元 2050 年）淨零排放為絕對目標，並設定溫室氣體排放強度（每單位營收的公噸二氧化氮當量）為管理目標，目標值為：以 107 年為基準年，119 年之溫室氣體排放強度較基準年減少 55%，並逐步達成 139 年（西元 2050 年）集團淨零排放之絕對目標。對於氣候變遷本公司以減少「溫室氣體排放」為主要指標進行減量與管控，並輔以「節約並有效運用能資源」指標作為監督管理政策。本公司溫室氣體排放總量（範疇一+範疇二）約 249,924.67 公噸 CO2e，超過 98%以上皆為外購電力的耗用，範疇二減量是我們達成淨零的關鍵議題。本公司於 110~113 年，分別購置 5 張、8 張、17 張及 2,840 張台灣再生能源憑證，朝提高能源效率、促進節能節水、減少溫室氣體排放、水回收、廢棄物再生材料，積極尋求減碳策略，持續將氣候變遷納入公司治理，提升高階管理的監督機制，邁向低碳營運轉型之目標前進。113 年除陸續執行廠內之節能改善管理措施外，太陽能案場之設置，累計至 113 年已取得 7,206.15 kW，預計 114 年再取得 1,509.46 kW，總建置量達 8,715.61 kW。</p> <p>9. 請詳以下 2-2 及 2-3 說明。</p> <p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。</p>

2-2. 最近二年公司溫室氣體盤查及確信情形

年度 (註)	範圍	總排放量 (公噸 CO ₂ e)		密集度 (公噸 CO ₂ e/當年度營收(百萬元))		確信 機構 準則	確信意見
		範疇一	範疇二	範疇三	範疇一與範疇二		
113 年	台灣所有廠區、 上海子公司、美 國子公司	3,891.60	246,033.07	105,286.77		TUV NORD	ISO 14064-3 TUV NORD 核發範疇一和範疇二之合理保證等級及範疇三有限保證等級之查驗聲明書，並無保留意見事項。
112 年	台灣所有廠區、 上海子公司、美 國子公司	4,523.52	231,377.99	76,752.78		TUV NORD	ISO 14064-3 TUV NORD 核發範疇一和範疇二之合理保證等級及範疇三有限保證等級之查驗聲明書，並無保留意見事項。
111 年	台灣所有廠區、 上海子公司、美 國子公司	4,302.65	238,010.04	50,227.83		BSI	ISO 14064-3 BSI 核發範疇一和範疇二之合理保證等級及範疇三有限保證等級之查驗聲明書，並無保留意見事項。

註：使用 ISO 14064-1 盤查驗證標準。

2-3. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

不適用，因本公司不符合金管會於 112 年 11 月 13 日所發佈之金管證發字第 11203852314 號令應揭露之時程。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層管理落實經營政策之承諾？	V	(一)本公司訂有經董事會通過之「誠信經營作業程序及行為為指南」，明定誠信經營之政策及作法並要求南茂成員包含董事及高階管理階層等落實誠信經營之政策，本「誠信經營作業程序及行為為指南」詳見於公司網站。	無差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V	(二)本公司已建立不誠信行為風險之評估機制，一年一次評估營業活動，並據以訂定防範不誠信行為風險之方案。在「誠信經營作業程序及行為為指南」、「從業道德規範」及「道德行為準則」等規範中，明定南茂成員包含董事及高階管理階層等嚴禁行賄或收賄、不得提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、禁止侵害智慧財產權、不得與第三人有不正當往來之關係、禁止違反公平交易法之交易行為、禁止未經公司同意而任意發布內部重大訊息等行為。	無差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V	(三)本公司訂有經董事會通過之「誠信經營作業程序及行為為指南」，明定防範各類不誠信行為之作業程序及行為為指南，並訂有檢舉辦法包含檢舉管道與處理流程。內部稽核依不誠信行為風險評估結果，規劃查核防範方案遵循情形，查核結果及後續改善方	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
	是	否	
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V	案作成稽核報告提報董事會，以確認防範方案的有效性。	無差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V	(一)本公司於商業往來前，評估往來對象之相關資訊，排除有不誠信行為紀錄者，並與往來交易對象簽訂之契約中明訂應遵循的誠信行為條款。 (二)本公司由法務室負責推動企業誠信經營，並定期一年一次向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。113 年度進行了「從業道德規範」及「誠信經營作業程序及行為為指南」等相關法規宣導。	無差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V	(三)本公司「誠信經營作業程序及行為為指南」、「從業道德規範」及「道德行為準則」規定本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司法務室，直屬主管應提供適當指導。本公司董事對董事會議案與其自身有利害關係於討論及表決時會予以迴避。	無差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託稽核報告提報董事會。另外，會計師依	V	(四)本公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，並由公司稽核室依風險評估結果定期查核，其查核結果及後續改善方案作成稽核報告提報董事會。另外，會計師依	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因																				
	是	否	摘要說明																					
會計師執行查核？			“SOX404 法案”執行內控審查包含 COSO 五要素。																					
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		<p>(五)113 年本公司舉辦各形式之教育訓練以推動誠信經營之落實：</p> <ol style="list-style-type: none"> 發送「從業道德規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關法規宣導信件予全體員工共 4 次。 參與誠信經營議題相關課程計 5,714 人 次，合計時數為 2,952.7 小時。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>課程名稱</th> <th>執行方式</th> <th>受訓人次</th> <th>受訓時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新人訓品質單元 (RBA)</td> <td>線上</td> <td>1,189</td> <td>986.87</td> </tr> <tr> <td>RBA 課程</td> <td>實體</td> <td>87</td> <td>696.00</td> </tr> <tr> <td>永續小學堂</td> <td>線上</td> <td>1,176</td> <td>563.03</td> </tr> <tr> <td>年度複訓品質單元 (RBA)</td> <td>線上</td> <td>3,262</td> <td>706.80</td> </tr> </tbody> </table>	課程名稱	執行方式	受訓人次	受訓時數	新人訓品質單元 (RBA)	線上	1,189	986.87	RBA 課程	實體	87	696.00	永續小學堂	線上	1,176	563.03	年度複訓品質單元 (RBA)	線上	3,262	706.80	無差異
課程名稱	執行方式	受訓人次	受訓時數																					
新人訓品質單元 (RBA)	線上	1,189	986.87																					
RBA 課程	實體	87	696.00																					
永續小學堂	線上	1,176	563.03																					
年度複訓品質單元 (RBA)	線上	3,262	706.80																					
三、公司檢舉制度之運作情形																								
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		<p>(一)本公司已制訂「誠信經營作業程序及行為指南」並規定若發現本公司任何員工有不誠信行為時，可隨時透過電子郵件檢舉信箱舉報（audit_committee@chipmos.com）。</p> <p>舉報事件交由公司的獨立單位稽核室進行調查。</p>	無差異																				
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		<p>(二)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，明確規範受理檢舉後之標準處理程序、調查後之措施及處分及相關保密機</p>	無差異																				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	制。	(三)本公司對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密並保護檢舉人不因檢舉情事而遭到不利之懲處及任何形式之報復行為。	無差異
四、加強資訊揭露	V	本公司已於公司網站放置含「誠信經營作業程序及行為指南」、「從業道德規範」及「道德行為準則」等誠信經營相關規範，以供同仁隨時查詢；公司網站及公開資訊觀測站，揭露所訂誠信經營守則內容及推動成效。網址如下： https://www.chipmos.com/chinese/csr/editor.aspx?CCID=42	無差異	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「從業道德規範」及「道德行為準則」，南茂成員包含董事及高階管理階層等均必須遵守該相關辦法之規定。本公司誠信經營運作情形與守則之內容並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)				
(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。				
(八)內部控制制度執行狀況				

1. 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站 > 公司治理 > 公司規章 / 內部控制 > 內控聲明書公告 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 第十屆第十九次董事會會議（113 年 2 月 22 日），通過主要議案如下：
 - (1) 一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。
 - (2) 一百一十二年度盈餘分派案。
 - (3) 一百一十三年度股東常會改選第十一屆董事（含獨立董事）九名案。
 - (4) 解除第十一屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第 209 條競業禁止之限制案。
 - (5) 召開一百一十三年股東常會相關事宜案。
 - (6) 一百一十三年度股東常會受理股東提案及受理董事（含獨立董事）提名之期間及場所案。
 - (7) 通過解除經理人競業禁止之限制案。
 - (8) 重要營運主管異動案。
2. 第十屆第二十次董事會會議（113 年 4 月 11 日），通過主要議案如下：
 - (1) 本公司 112 年度（西元 2023 年度）Annual Report on Form 20-F（其中包含本公司依據國際財務報導準則編製之 112 年度（西元 2023 年度）英文合併財務報告）。
3. 第十屆第二十一次董事會會議（113 年 5 月 9 日），通過主要議案如下：
 - (1) 本公司一百一十三年第一季合併財務報告案。
4. 第十一屆第一次董事會會議（113 年 5 月 30 日），通過主要議案如下：
 - (1) 推選董事長案。
 - (2) 本公司第二屆提名委員會委員委任案。
5. 第十一屆第二次董事會會議（113 年 6 月 11 日），通過主要議案如下：
 - (1) 訂定配息基準日案。
 - (2) 本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任案。
 - (3) 本公司授權子公司 ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD. 辦理現金減資退還股款案。
6. 第十一屆第三次董事會會議（113 年 8 月 13 日），通過主要議案如下：
 - (1) 本公司一百一十三年第二季合併財務報告案。
7. 第十一屆第四次董事會會議（113 年 11 月 5 日），通過主要議案如下：
 - (1) 本公司一百一十三年第三季合併財務報告案。
 - (2) 通過解除經理人競業禁止之限制案。
8. 第十一屆第五次董事會會議（114 年 1 月 21 日），通過主要議案如下：
 - (1) 本公司擬依法買回本公司股份並辦理銷除案。
9. 第十一屆第六次董事會會議（114 年 2 月 25 日），通過主要議案如下：
 - (1) 一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。
 - (2) 一百一十三年度盈餘分派案。
 - (3) 修訂「公司章程」案。

- (4) 修訂「股東會議事規則」案。
- (5) 修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。
- (6) 召開一百一十四年股東常會相關事宜案。
- (7) 一百一十四年度股東常會受理股東提案之期間及場所案。

10. 第十一屆第七次董事會會議（114 年 4 月 15 日），通過主要議案如下：

- (1) 本公司 113 年度（西元 2024 年度）Annual Report on Form 20-F（其中包含本公司依據國際財務報導準則編製之 113 年度（西元 2024 年度）英文合併財務報告）。
- (2) 減資註銷庫藏股案。
- (3) 召開一百一十四年股東常會相關事宜案（增列議案）。

11. 一百一十三年股東常會（113 年 5 月 30 日）通過主要議案如下：

(一) 承認事項

- (1) 一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。
執行情形：決議通過。
- (2) 一百一十二年度盈餘分派案。
執行情形：決議通過，於 113 年 7 月 19 日完成盈餘分配。

(二) 選舉事項

- (1) 改選第十一屆董事（含獨立董事）九名案。
執行情形：由董事會所提九名候選人當選，任期自民國一百一十三年五月三十日起至民國一百一十六年五月二十九日止。

(三) 其他議案

- (1) 解除第十一屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第 209 條競業禁止之限制案。
執行情形：決議通過，解除第十一屆當選董事（含獨立董事）之競業禁止。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊

(一) 紿付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容

單位:新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會 計師事務所	林佳鴻	113.01.01～ 113.12.31	15,730	3,150	18,880	
	徐建業					

註：非審計公費係申請稅務簽證相關之費用\$3,150仟元。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	113年2月22日經董事會通過		
更換原因及說明	因資誠聯合會計師事務所徐建業會計師及梁益彰會計師截至一百一十二年底擔任本公司財務報表查核簽證會計師已接近屆滿五年，為配合會計師事務所內部輪調，本公司自一百一十三年第一季起原主辦會計師徐建業會計師調整為會簽會計師，而主辦會計師改由林佳鴻會計師擔任。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受（繼續）委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
		V	
	說明		
其他揭露事項 (公開發行公司年報應記載事項準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	林佳鴻、徐建業
委任之日期	113 年 2 月 22 日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三) 前任會計師對公開發行公司年報應記載事項準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

(一) 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

- (1) 股權轉移：請參閱公開資訊觀測站 > 單一公司 > 股權變動／證券發行 > 股權轉讓資料查詢 > 內部人持股異動事後申報表 (https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)。
- (2) 股權質押變動情形：公開資訊觀測站 > 單一公司 > 股權變動／證券發行 > 內部人設質解質 > 內部人設質解質公告 (https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)。

(二) 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉變動情形（股權移轉之相對人為關係人者）：無。

(三) 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押變動情形（股權質押之相對人為關係人者）：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年3月29日（單位：股；%）

姓名	本人 持有股份		配偶、未成 年子女持有 股份		利用他人名義 合計持有股份		前十名股東相互間具 有關係人或為配偶、 二親等以內之親屬關 係者，其名稱（或姓 名）及關係		備註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
矽品精密工業股份有限公司 代表人：蔡祺文	78,910,390	10.85	—	—	—	—	無	無	—
資料無法取得									
一銀受託保管南茂科技存託憑證專戶	72,526,594	9.97	—	—	—	—	無	無	—
焱元投資股份有限公司 代表人：關鈞	41,200,000	5.67	—	—	—	—	無	無	—
資料無法取得									
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	15,692,000	2.16	—	—	—	—	無	無	—
資料無法取得									
南茂科技（股）公司同意股份買回專戶	10,000,000	1.38	—	—	—	—	無	無	—
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	7,982,348	1.10	—	—	—	—	無	無	—
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管 ENSIGNPEAK 顧問公司投資專戶	7,382,347	1.02	—	—	—	—	無	無	—
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	6,901,649	0.95	—	—	—	—	無	無	—
上海商業儲蓄銀行股份有限公司 代表人：李慶言	6,861,000	0.94	—	—	—	—	無	無	—
資料無法取得									
第一商業銀行受託保管群益台灣半導體收益 E T F 證券投資信託基金專戶	6,844,000	0.94	—	—	—	—	無	無	—

註：截至114年3月29本公司已發行股數總額727,240,126股。

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，
並合併計算綜合持股比例

113年12月31日（單位：股；%）

轉投資事業 (註 1)	本公司投資		董事、經理人及直接 或間接控制事業之投 資		綜合投資	
	股數	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)
ChipMOS U.S.A., Inc.	3,550,000	100.00	—	—	3,550,000	100.00
ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD.	1,262,005,475	100.00	—	—	1,262,005,475	100.00
南茂半導體（上海）有限公司	—	—	(註 2)	100.00	(註 2)	100.00
易華電子股份有限公司	8,300,000	10.00	—	—	8,300,000	10.00
晶成能源股份有限公司	2,070,000	10.00	—	—	2,070,000	10.00

註1：係公司採用權益法之長期投資。

註2：係屬有限公司，故未發行股份。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

單位：新台幣仟元；仟股

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
108.03	10	970,000	9,700,000	752,835	7,528,347	註銷收回之限制員工權利新股	無	(註 1)
108.04	10	970,000	9,700,000	740,086	7,400,859	註銷庫藏股	無	(註 2)
108.08	10	970,000	9,700,000	727,312	7,273,124	註銷庫藏股暨收回之限制員工權利新股	無	(註 3)
108.09	10	970,000	9,700,000	727,240	7,272,401	註銷庫藏股	無	(註 4)

註 1：108.3.21 註銷收回之限制員工權利新股 22,948 股，減少股本 229,480 元後實收資本額為 7,528,347,340 元，經科技部新竹科學園區竹商字第 1080007952 號函核准。

註 2：108.4.3 註銷庫藏股 12,748,847 股，減少股本 127,488,470 元，減資後實收資本額為 7,400,858,870 元，經科技部新竹科學園區竹商字第 1080009251 號函核准。

註 3：108.8.15 註銷庫藏股 12,748,847 股及註銷收回之限制員工權利新股 24,671 股，減少股本 127,488,470 元及 246,710 元後實收資本額為 7,273,123,690 元，經科技部新竹科學園區竹商字第 1080023455 號函核准。

註 4：108.9.23 註銷庫藏股 72,243 股，減少股本 722,430 元，減資後實收資本額為 7,272,401,260 元，經科技部新竹科學園區竹商字第 1080027435 號函核准。

2. 股份種類

114年3月29日（單位:股）

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份（註）	未發行股份	合計	
普通股	727,240,126	242,759,874	970,000,000	

註：股票在台灣證券交易所掛牌上市。

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

114年3月29日

主要股東名稱	股份	持有股數（股）	持股比例（%）
矽品精密工業股份有限公司		78,910,390	10.85
一銀受託保管南茂科技存託憑證專戶		72,526,594	9.97
焱元投資股份有限公司		41,200,000	5.67

主要股東名稱	股份	持有股數（股）	持股比例（%）
中華郵政股份有限公司		15,692,000	2.16
南茂科技（股）公司同意股份買回專戶		10,000,000	1.38
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		7,982,348	1.10
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管E N S I G N P E A K顧問公司投資專戶		7,382,347	1.02
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶		6,901,649	0.95
上海商業儲蓄銀行股份有限公司		6,861,000	0.94
第一商業銀行受託保管群益台灣半導體收益E T F證券投資信託基金專戶		6,844,000	0.94

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司章程規定，本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘加計期初累計未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額作為可供分派盈餘，由董事會視營運需要酌予保留後，如仍有盈餘，提請股東會決議分派全部或部分派付股東股利。本公司股東股利分派議案，係由董事會視公司歷年盈餘、目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，並兼顧股東利益、平衡股利及公司長期之財務規劃，每年依法由董事會擬具，提報股東會決議。本公司盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，其中現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之百分之十為限。

本公司股利之發放係依公司資本結構、營運狀況、累積盈餘、各項公積、投資計劃及參考同業以決定，由董事會擬具盈餘分派議案，提報股東會決議後分派之。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

本公司 113 年度稅後盈餘為新台幣 1,419,995 仟元，經 114 年 2 月 25 日董事會通過，擬配發股東現金股利每股新台幣 1.2 元，共計新台幣 872,688 仟元。本案將俟 114 年 5 月 27 日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票

或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不超過百分之零點伍為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

依公司章程估列員工及董事酬勞，若次年度董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於董事會決議年度調整損益。

3. 董事會通過之分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：本公司 114 年第十一屆第六次董事會通過配發員工酬勞新台幣 186,484 仟元及董事酬勞新台幣 4,662 仟元。與認列費用年度估列金額無差異數。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司無配發員工股票酬勞。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形

1. 公司買回本公司股份情形（已執行完畢者）

114年4月15日

買回期次	第四次（期）
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回期間	114 年 1 月 22 日 至 114 年 3 月 21 日
買回區間價格	21.18 元至 35.00 元
已買回股份種類及數量	普通股 10,000,000 股
已買回股份金額	新台幣 321,704,845 元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	100
已辦理銷除及轉讓之股份數量（註 1）	0 股
累積持有本公司股份數量	10,000,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%)（註 2）	1.38

註1：本公司114年4月15日董事會通過減資基準日為114年5月28日。

註2：截至114年3月29日本公司已發行股數總額727,240,126股。

2. 公司買回本公司股份情形（尚在執行中者）：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形

114年4月15日

項目	發行（辦理）日期	105 年 11 月 1 日	
發行（辦理）日期	105.11.1		
發行及交易地點	那斯達克證券交易所		
發行總金額	不適用		
單位發行價格	不適用		
發行單位總數	21,775,257 單位		
表彰有價證券之來源	本公司普通股		
表彰有價證券之數額	435,505,140 股		
存託憑證持有人之權利與義務	與普通股同		
受託人	無		
存託機構	美商花旗銀行		
保管機構	第一銀行		
未兌回餘額	3,596,329 單位		
發行及存續期間相關費用之分攤方式	由本公司負擔		
存託契約及保管契約之重要約定事項	無		
每 單 位 市 價	113 年	最高	US\$32.19
		最低	US\$18.20
		平均	US\$25.19
	當年度截至 114 年 4 月 15 日	最高	US\$21.15
		最低	US\$12.78
		平均	US\$18.48

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形

(一) 員工認股權憑證辦理情形：無。

(二) 限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

(一)最近年度及截至年報刊印日止，已完成併購或受讓他公司股份發行新股

1. 最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：
不適用。

2. 除前項規定之公司外，應揭露最近一季執行情形，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計畫：不適用。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股：無。

七、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司主要業務為從事各種積體電路之封裝及測試服務，同時也提供客戶全段加工及配貨之服務。

2. 所營業務之營業比重

本公司合併營收來源為提供封裝及測試加工服務，封裝、測試的產品可大致分為記憶體及 LCD 驅動 IC、邏輯/混合 IC 三大主軸，基於製程特性的考量及利潤中心的營運管理需求而區分為「封裝生產本部」、「記憶體暨混合訊號測試生產本部」、「LCDD 生產本部」及「晶圓凸塊生產本部」四個事業部門，均隸屬於「營運製造中心」，由於產品營收、成本及毛利均以部門別為歸屬，據此將本公司產品區分為四大類，故主要產品之營業比重說明如下：

單位：新台幣仟元；%

主要部門別	111 年度		112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
封 裝	6,705,898	28.52	4,629,430	21.68	5,390,447	23.75
測 試	5,243,997	22.30	4,394,726	20.58	4,967,849	21.89
平面顯示器驅動 IC	7,288,642	30.99	7,821,640	36.62	7,318,997	32.25
晶圓凸塊	4,278,527	18.19	4,510,432	21.12	5,018,616	22.11
合計	23,517,064	100.00	21,356,228	100.00	22,695,909	100.00

註：經會計師查核簽證之合併財務報告。

3. 公司目前之商品（服務）項目

本公司主要的產品有多晶片封裝（Multi-Chip），超薄小型晶粒承載器積體電路（TSOP）、錫球陣列封裝（BGA）、DFN/QFN、捲帶式薄膜覆晶封裝（COF）、玻璃覆晶（COG）及塑膠基板覆晶（COP）等之封裝及測試代工和晶圓凸塊製造（Bumping）、晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）/覆晶封裝技術（Flip Chip）。經本公司提供整體性積體電路封裝與測試服務後，客戶的產品主要應用在車用、資訊、通訊、手機、穿戴及消費性電子等相關產品。

4. 計畫開發之新商品（服務）項目

本公司及子公司未來除了持續增加高階記憶體之封裝測試服務產能外，亦將依市場之應用與需求，提升及增加下列領域產品之封裝測試技術與產能：

- (1) 開發銀合金凸塊製程於顯示驅動 IC 應用。
- (2) 開發應用於記憶體產品的 1M1P 重佈線（RDL）結構。

- (3) 開發應用於 Micro-LED TV 顯示器的雙層覆晶薄膜（COF）雙晶片技術。
- (4) 開發應用於覆晶薄膜軟板封裝（COF）的非矩形金凸塊製程技術。
- (5) 開發覆晶與打線製程混合鍵合封裝技術。
- (6) 開發具散熱片之覆晶晶片尺寸級封裝。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

112 年台灣 IC 封測產業產值達新台幣 5,837 億元，年增率為 -14.8%，預估 113 年台灣封裝及測試業產值達新台幣 6,235 億元，較 112 年成長 6.8%，主因受惠於行動通訊及車用電子產品對先進封裝的需求量上升，因此帶動高 I/O 數和高整合度的高階、先進封裝技術如 WLCSP (Fan-in 和 Fan-out) 等滲透率持續上升，加上記憶體價格上漲，市場對封測產品質和量的要求同步提升。

台灣半導體產業之各細項產值

單位:新台幣億元；%

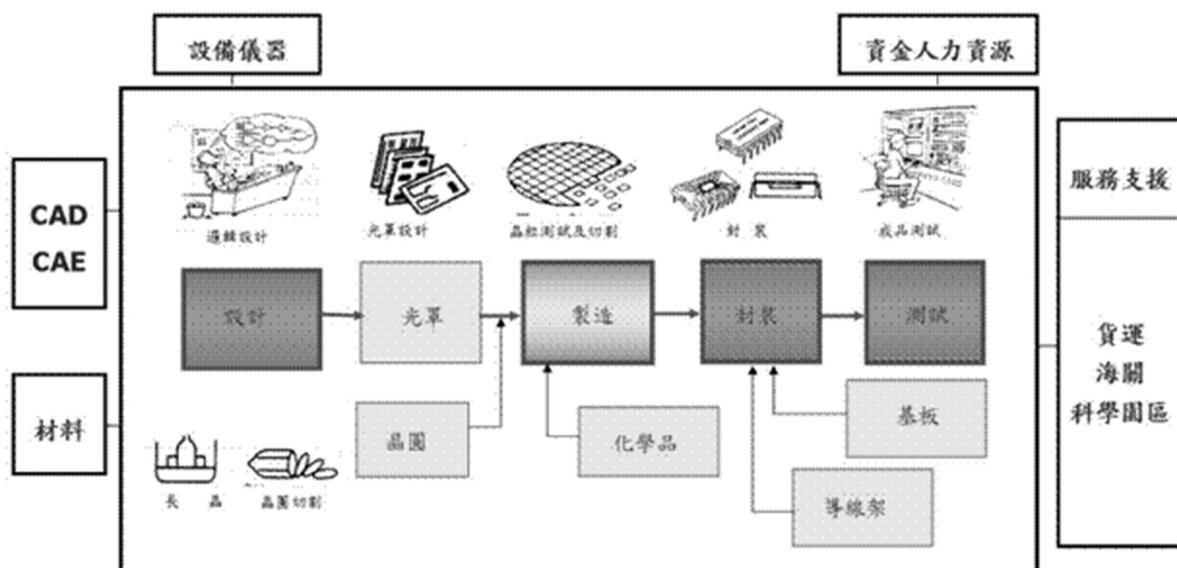
項目	111 年		112 年		113 年		
	金額	金額	比重 (%)	年增率 (%)	金額	比重 (%)	年增率 (%)
IC 設計業	12,320	10,965	25.25	-11.0	12,721	23.93	16.0
IC 製造業	29,203	26,626	61.31	-8.8	34,195	64.34	28.4
晶圓代工	26,847	24,925	57.39	-7.2	32,438	61.03	30.1
記憶體及 IDM	2,356	1,701	3.92	-27.8	1,757	3.31	3.3
IC 封測業	6,847	5,837	13.44	-14.8	6,235	11.73	6.8
IC 產業產值	48,370	43,428	100.00	-10.2	53,151	100.00	22.4

資料來源：工研院 IEK (113/12)

2. 產業上、中、下游之關聯性

我國半導體產業隨著整體半導體的垂直分工整合的趨勢演進，依製造流程可區分為上游之 IC 設計公司 (IC Design)、中游之 IC 晶圓製造廠 (IC Manufacturing and Foundry) 及下游之 IC 封裝、測試廠 (IC Assembly and Testing)。近年來由於我國 IC 產業蓬勃發展及分工體系走向專業化，每一個生產環節皆有許多個別廠商投入，垂直分工明確且各有專精，使我國 IC 產業之上、中、下游結構更加完整。茲將本公司所屬產業之上、中、下游之關聯性列示如下，本公司主要業務為提供記憶體 IC、LCD 驅動 IC 及邏輯/混合訊號 IC 後段封裝及測試代工服務 (IC Back-End Services)，屬半導體的下游產業。

我國半導體產業結構圖



資料來源：MIC、工研院 IEK（102/04）。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 發展趨勢

A. IC 封測業

a. 三維晶片（3D IC）將成為未來先進封裝必經之路

鑑於電子產品對於輕薄短小、高效能、高整合度及低功耗之需求，能夠整合各 IC 之多晶片封裝技術如系統單晶片（System on Chip, SoC）、系統級封裝（System in Package, SiP）及三維晶片（3D IC）遂成為未來先進封裝發展趨勢。

3D IC 具有縮短內部連接線、縮小晶片尺寸等優勢，故近年來 3D IC 主流技術逐步崛起，而封裝型態也朝矽穿孔（TSV）的方式發展，其封裝型態並非傳統 Wire Bond 打線接合，而是在每一個晶圓以蝕刻方式鑽孔，再以導電材質填滿來作連接功能，將所有晶片做一結合，縮短金屬導線長度及連線電阻，減少晶片面積。隨著數位電子對於輕薄短小、高效能的需求，高度系統整合與無線化為必然趨勢，3D IC 全新架構可滿足此市場發展趨勢，如 AI HBM、智慧型手機對 IC 的功能與頻寬要求甚高，而透過 3D IC 則可達到增加頻寬、縮小元件體積的目標。相較於 3D IC，SoC、SiP、TSV 等封裝技術則各有其優劣勢，其中 SoC 技術在節能、低容量產品成本的表現相對優異，以量大且生命週期長的產品為主；而 SiP 則是在異質整合、生產速度、設計資源再利用、研發時間等層面較具優勢，最適合用於即時上市與高異質整合的產品；TSV 則是以效能、高容量產品成本等項目的表現為佳，現階段多應用於記憶體、影像感測器、微機電系統（MEMS）等領域；而 3D IC 因兼具小型化、高效能、更易於高度異質整合的應用等優勢，因此成為現階段半導體封裝界主力發展的技術。

b. AI HBM (High Bandwidth Memory) 以及智慧型手持裝置、車用電子占半導體應用市場比率持續竄升

未來邏輯 IC 和 Mobile DRAM 之整合，AI HBM、智慧型手持裝置以及車用電子將成為最大應用市場，而隨著全球 AI HBM、智慧型手持裝置以及電動車熱潮持續蔓延，市場呈現大幅成長趨勢，已成為全球半導體市場重要成長動力，而全球 IC 設計公司在 AI HBM、智慧型手持裝置市場 CPU、GPU、Baseband、網通晶片等元件的競爭力，也帶動晶圓代工與 IC 封測市場的成長，此外，AI HBM、智慧型手持裝置以及車用電子銷售的擴張，也加速半導體元件朝向高效率、高整合、低耗能等方向發展，若能夠把握 AI HBM、智慧型手持裝置以及車用電子崛起的轉折點，將成為營收成長的契機。

c. 封測業將呈現大者恆大之趨勢

隨著電子終端裝置朝輕薄短小趨勢發展，而價格卻持續走跌，間接壓抑對材料成本較為依賴的封測業之價格及利潤，未來若是無足夠經濟規模的廠商將面臨成本控管越發嚴峻之狀況，且隨著各家半導體大廠邁入更加高階之製程，搭配之封裝難度也同步提高，所需投入之資本支出也越發龐大，因此規模較小之封測廠若無法佔有利基市場，在產業大者恆大之趨勢下，未來競爭力將持續下滑。

B. 儲存設備業

NAND Flash 逐漸成為全球記憶體市場之主流，近年來 DRAM 及 NAND Flash 銷售額比重呈現一消一長局面，反映出智慧型手機、平板電腦日漸普及，且雲端運算興起對兩大記憶體產品已產生不同的影響，甚至未來在智慧型手機直接導入內建式 NAND Flash 及行動裝置處理器的廠商陸續推出支援內嵌式記憶體 (eMMC/eMCP) 應用的解決方案，確立未來智慧型手機儲存將以內建式 NAND Flash 為大宗，以及 Ultrabook 的崛起成功使 PC 產業加速導入固態硬碟，加上數據中心伺服器對於 NAND Flash 的需求也將攀升之下，NAND Flash 已超越 DRAM 成為全球最大記憶體產品。

C. 平面顯示器終端應用產業

a. 各項裝置將朝向超高解析度發展

隨著 Apple、Samsung 陸續推出高解析度的智慧型手機、平板電腦等產品，備受市場好評，吸引其他品牌業者紛紛搶進，高解析度面板已經成為各類型高階產品的必備規格。繼智慧型手機後，包括平板電腦、筆記型電腦、Ultrabook、甚至 LCD TV 均加快導入高解析度面板的腳步，在 Apple 推出採用指紋辨識模組的 New iPhone、MacBook Pro，促使 Samsung、華碩、宏碁、Dell 等其他品牌均加速指紋辨識模組導入手機、平板電腦、筆記型電腦、輕薄筆電產品。有鑑於液晶電

視市場銷售趨緩，包括日本、台灣面板廠均陸續投入 4K×2K 液晶面板的開發量產，未來將逐步導入高階 LCD 監視器、LCD TV 等產品。

b. AMOLED 被視為下一世代之先進顯示技術

AMOLED 因具備自發光之特性，不僅反應時間短，在效能上能達到高對比，得以表現出極為鮮艷的色彩，同時能夠達到有效降低面板的消耗電力，且由於不需藉助背光源點亮即可發光，因此能更有效降低產品之厚度，同時由於 AMOLED 面板可在軟性基板上加工，具備可彎曲之特性。大陸的手機廠 AMOLED 搭載率增加，加上 Apple 也正在與面板廠協商 iPhone 的 OLED 面板的供貨事宜，預期將帶動更多的手機業者跟進，AMOLED 的市占率可望逐年增加。

(2) 競爭情形

A. 驅動 IC 後段封測 12 吋 Gold Bumping 與測試機台為擴產重點

台灣 LCD 駆動 IC 封測產業歷經整併後，小廠紛紛被併購，相關後段廠商（如：福祿、悠立、米輯、頤邦、華宸、飛信、南茂、利弘、慎立、矽品等）經整併後，目前主要僅存頤邦和南茂 2 家廠商，致 LCD 駆動 IC 後段封測形成寡占市場。由於台灣前 2 大廠商頤邦、南茂之產能大幅領先競爭對手，並能提供 Turnkey Services，有利維繫產業秩序。目前各家廠商的 8 吋晶圓凸塊（Gold Bumping）在旺季時，產能利用率僅 70%，此閒置部份的產能未來將轉電源管理 IC、微機電系統（MEMS）和晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）等其他應用產品的封測；而隨著智慧型手持裝置需求快速成長，Mobile Device 面板解析度提升使小尺寸驅動 IC 設計日益複雜，測試時間拉長，致 12 吋晶圓凸塊（Gold Bumping）產能及測試機台為各廠商近年擴產重點。

由於中美貿易與法令限制，中國 LCD 半導體封測廠與晶圓廠迅速擴張，並且利用政府補助在市場低價競爭導致開始有更多客戶前往中國生產，本公司持續前往高端產品線（AMOLED、TDDI）與車用方面發展，利用自身品質與管理優勢拉開低價競爭區間。

B. 全球 DRAM 業由 Samsung、Micron、SK Hynix 「三強鼎立」格局確立

Micron 因擁有記憶體封測廠，故 Micron 釋出係以 DRAM 與 NAND Flash 封裝訂單為主，測試仍是 In House 為主。Micron 之台灣主要 DRAM/NAND 後段合作廠商為力成、南茂、日月光及華東。下一代的製程技術由 Micron 主導的機率高，而 Micron 的測試平台為自家開發，與大部份測試廠不同，測試廠若想持續接獲 Micron 訂單，將增加大筆資本支出購置新測試平台。由於本公司長久以來致力於生產效率提升及降低生產週期與物料成本，以提升價格競爭力；加以本公司較其他競爭對手與 Micron 維持長期緊密合作關係，並共同開發下一世代產品，適時進行未來新產品新製程的投資，以提升本公司之競爭力。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次、研究發展

(1) 所營業務之技術層次

本公司及子公司致力於封測業務已有 30 餘年的歷史，肇始於 75 年茂矽電子後段工程處，至 86 年正式獨立於茂矽電子之外至今已有 27 年，現是世界前十大封測廠之一。

封測代工，雖無己身固有產品，但涵蓋範圍之廣，大至國防工業，小至民生消費產品。另一方面，它專職於半導體整體供應鏈的後段，供應鏈上的任何環節出現異常，皆會影響 Time to Market。此外封測代工早已擺脫傳統且低門檻的世俗觀念，迎向的是持續製程微縮及不定期且急促的產業循環起伏，對於新世代 5G、人工智慧、電動車及雲端運算等新興運用之崛起，必須隨時準備最佳的整合方案提供給客戶，達到雙贏的合作模式。

為了持續立足於封測業，本公司戮力於產品技術研發已有十餘年。封測研發，泛指基礎領域而言，不外乎本行的材料、機械特性以及越來越受到重視的電氣特性，大體是由三種主要領域搭配其他組合而成之研究核心，其相關闡述如下：

A. 材料

由於封裝體的主要使命就是保護 IC，避免外界應力及環境汙染的影響，且確保內部的任何異質接面處在長期使用下是穩定的狀態。所以材料的選擇與應用尤其重要。材料放置於一封裝體內，應有最佳化的組合。最好的封裝體是經過嚴苛的老化測試 (JEDEC 標準) 仍有一定的特性，這才是最適合的材料搭配。另外如何選用低成本的封裝材料以滿足客戶對於降低產品的成本需求，一向是本公司的研發重點。

B. 機械特性

要保護內部 IC 晶片避免受到外力作用而導致失效，重點是產品外部要夠堅固之外，內部的應力必須儘量消弭於無形，尤其是對微縮產品於應用時產生之週期性、瞬間型的熱應力所導致的翹曲會讓介面於接點處造成永久性傷害，導致元件失效。因此機械特性需要事前模擬以及事後量測，透過各方面的分析來了解該結構的特性及誤差。

C. 電氣特性

由於封裝體的其他使命就是將訊號由 IC 晶片分散至 PCB 板上，經由載板的設計可以達成。但面對日新月異的消費性電子產品，高速高頻/微波射頻儼然已成為趨勢，因此電氣特性需要事前模擬以及事後不同方式的量測，來符合客戶的不同需求。

統合上述三項基礎研究，針對不同客戶的產品，透過不同的特性取捨達到優化封裝體為目標。要優化各世代之主流封裝體，所倚賴的唯有先進研發能量，透過以下研究發展之計畫，可循序了解目前主流封裝技術以及本公司獨到能力所在。

(2) 研究發展

113 年度封裝測試技術研究與發展計畫

1. 開發 2P2M 之厚銅佈線 (RDL) 結合高銅柱應用於電源管理晶片封裝需求。
2. 開發 12 吋單機版薄化技術應用於晶圓級晶片尺寸封裝 (WLCSP)。
3. 研發極窄寬度 (<0.42mm) 平面顯示器驅動 IC 於 COF 封裝技術服務。
4. 開發 COF 封裝製程應用於非平面顯示器驅動 IC 之技術服務。
5. 開發第五代 DDR 同步動態隨機存取記憶體封裝技術。
6. 開發 Thermal enhanced Flip-chip BGA with Heat sink 封裝技術開發。

114 年度封裝測試技術研究與發展計畫

1. 開發銀合金凸塊製程於顯示驅動 IC 應用。
2. 開發應用於記憶體產品的 1M1P 重佈線 (RDL) 結構。
3. 開發應用於 Micro-LED TV 顯示器的雙層覆晶薄膜 (COF) 雙晶片技術。
4. 開發應用於覆晶薄膜軟板封裝 (COF) 的非矩形金凸塊製程技術。
5. 開發覆晶與打線製程混合鍵合封裝技術。
6. 開發具散熱片之覆晶晶片尺寸級封裝。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日
A. 研發費用	1,162,765	—
B. 營業收入	22,695,909	—
A/B	5.12%	—

註：截至年報刊印日止，最近期 114 年 3 月 31 日之合併財務報告尚未經董事會通過及會計師核閱。

3. 最近年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品

年度	研發成果	內容說明
113 年	開發 2P2M 之厚銅佈線 (RDL) 結合高銅柱應用於電源管理晶片封裝需求	1. 開發厚銅佈線 (RDL) 結合高銅柱的 2P2M 結構 2. 應用於電源管理晶片封裝業務
	開發 12 吋單機版薄化技術應用於晶圓級晶片尺寸封裝 (WLCSP)	1. 提供 12 吋薄化技術於單機版機台，提升廠內機台單機作業能力和市場競爭力 2. 薄化晶圓級晶片尺寸封裝 (WLCSP) 應用方案建置
	研發極窄寬度 (<0.42mm) 平面顯示器驅動 IC 於 COF 封裝技術服務	1. 導入 IC 寬 (<0.42mm) COF 封裝量產技術 2. 應用於降低驅動晶片封測生產成本
	開發 COF 封裝製程應用於非平面顯示器驅動 IC 之技術服務	1. 開發超小晶片其窄長/寬 (皆 $\leq 1\text{mm}$) 之 COF 封裝技術導入於非驅動 IC 之產品應用 2. 發展高抗彎折強度 ($>350\text{Mpa}$) 之晶片封裝技術於非驅動 IC 之產品應用

年度	研發成果	內容說明
114 年	開發第五代 DDR 同步動態隨機存取記憶體封裝技術	1. 開發高速與高頻寬 DDR5 DRAM 封裝工藝以符合產品規格
	開發 Thermal enhanced Flip-chip BGA with Heat sink 封裝技術開發	1. 開發高效能運算 Flip-chip BGA 封裝工藝 2. 導入散熱片封裝技術以符合產品需求
	開發銀合金凸塊製程於顯示驅動 IC 應用	1. 開發銀金凸塊製程，結合金凸塊與銅鎳金凸塊兩種製程結構之優點，兼具品質與成本優勢 2. 應用於顯示驅動 IC，並導入品牌市場
	開發應用於記憶體產品的 1M1P 重佈線 (RDL) 結構	1. 提供 Fine Pitch 1M1P 之 RDL 技術服務應用於記憶體打線封裝 2. 由傳統 2P1M 改成 1M1P 製程結構，提升市場競爭力
	開發應用於 Micro-LED TV 顯示器的雙層覆晶薄膜 (COF) 雙晶片技術	1. 發展新世代設計技術符合雙 IC 封裝工藝規格 2. 應用於大尺寸 (>90 吋) 與高刷新率 (90 & 120& 240 Hz 以上) 面板之顯示器
	開發應用於覆晶薄膜軟板封裝 (COF) 的非矩形金凸塊製程技術	1. 開發非正矩形金凸塊內引腳接合設計封裝技術 2. 導入非正矩形金凸塊封裝技術以符合 COP 產品需求
	開發覆晶與打線製程混合鍵合封裝技術	1. 開發覆晶與打線製程混合鍵合封裝工藝 2. 提昇資料存取速度以符合記憶體高速需求
	開發具散熱片之覆晶晶片尺寸級封裝	1. 開發高散熱 Flip-chip CSP 封裝工藝 2. 導入散熱片封裝技術以符合產品散熱需求

(四) 長、短期業務發展計畫

本公司及子公司多年來積極接觸客戶與市場，隨著客戶與市場之成長，本公司及子公司已成功奠定產品品質及公司形象基礎，並逐漸在市場上占有一席之地。因應產業發展趨勢及國內外市場競爭，期望藉由長短期發展計畫之實踐以調整公司體質，提升整體競爭力。

1. 短期業務發展計畫

(1) 半導體後段市場全程製造服務的提供者

- A. 提供核心技術產品全製造的服務。
- B. 專注於半導體封裝測試市場的產能並著重於與客戶共同研究開發產品技術，以期共創雙贏的局面。
- C. 持續與現有客戶維持良好關係，進而開發新客戶。
- D. 因應客戶需求擴大邏輯/混合訊號 IC (Mixed-Signal)、AMOLED、車載驅動 IC 產能並以微機電產品 (MEMS) 為進一步擴充目標。

(2) 大廠加速外包與企業整併挹注南茂技術服務業務

- A. IDMs (Integrated Device Manufacturer 整合設計製造業) 大廠持續地、加快腳步地增加半導體後段封裝測試外包業務，以因應快速縮短的產品壽命週期與材料價格的波動。

- B. 半導體封裝測試外包產業（OSATs）的歷史資料顯示，IDMs、晶圓代工廠及設計公司持續釋出產能。
- C. 目前大陸在半導體封測廠持續擴增並且希望”2025 中國製造”用政府的補助用低價去搶市場的份額，需要在技術與品質上面做出差異性。

(3) 與客戶建立起長期夥伴關係的經營策略

- A. 維持較高的利潤率
 - a. 有效率的管理且分散式的多角化經營策略，提高設備產能利用率。
 - b. 在少數同業競爭下，能維持較好的銷售價格與毛利。
 - c. 有效率的資金運用及產品組合的調整，進而提高利潤率。
- B. 在公司的核心業務範圍內，強化與具有領導地位的大廠及半導體公司的關係，依公司規劃的技術藍圖，與客戶密切合作，持續創新研究，並擴充產能。

2. 長期業務發展計畫

(1) 專注於高成長的終端應用市場

- A. 專注於特殊的終端應用市場。
- B. 運用尖端的半導體後段全製程技術服務，開發高成長的產品應用市場。
- C. 致力於核心技術的研發與創新，協助客戶降低營運成本。

(2) 著重於產能擴充及先進技術的發展與建立，建立足夠的產能，擴大高成長產品的市場佔有率

- A. 開發 12 吋晶圓細間距鍍線技術（Fine Pitch Bonding）用於液晶顯示器驅動 IC 產品。
- B. 建立覆晶封裝技術（Flip Chip）於記憶體及邏輯/混合訊號產品封裝的應用。
- C. 應用晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）和重佈線（RDL）技術於電子羅盤、磁力計（Magnetometer）和其他記憶體。
- D. 持續開發先進高利潤封裝產品的封裝技術，例如：堆疊式晶片封裝（Stacked-Die）、多晶片封裝（Multi-Chip）、系統級封裝（SiP）等。

(3) 積極建立全球性自有的智慧財產權資料庫以達捍衛專業技術之目的

以積極創新的研發能量配合客戶技術發展和新產品開發，並建立專利權發展平台，利用專利權移轉出售，以提高非核心技術的價值。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品（服務）之銷售（提供）地區

單位：新台幣仟元；%

地區	年度	112 年度		113 年度	
		金額	比率 (%)	金額	比率 (%)
	內銷	17,287,574	80.95	18,079,388	79.66
外銷	亞洲	3,624,809	16.97	4,070,863	17.94
	美洲	374,359	1.75	490,561	2.16
	其他	69,486	0.33	55,097	0.24
	小計	4,068,654	19.05	4,616,521	20.34
	合計	21,356,228	100.00	22,695,909	100.00

2. 市場占有率

本公司為專業之 IC 封裝測試公司，主要為 IC 設計公司、整合元件製造公司及 IC 晶圓廠提供記憶體 IC、LCD 驅動 IC 及邏輯/混合訊號產品之封裝測試服務，上述產品主要應用於電腦、消費性電子產品之儲存設備及顯示器之終端應用產品。依據工研院 IEK 統計資料顯示，113 年台灣 IC 封測產值約為新台幣 6,235 億元，本公司 113 年合併營收約為新台幣 227 億元，約占台灣產值 3.6%。本公司擁有多項封裝測試經驗及專業研發技術能力，提供適足之產能規模及全程後段服務以充分滿足客戶不同需求，近年來在營業規模方面有相當不錯之表現，顯示本公司產品及技術獲得客戶高度之肯定，在同業間已占有相當之競爭地位。

3. 競爭利基

(1) 產業經驗豐富之經營及技術研發團隊

本公司自 86 年成立以來，持續投入先進封裝領域相關之技術開發與研究，主要研發人員及經營階層於半導體產業皆有 10 年以上之工作經驗，累積相關豐富之封裝測試經驗，洞悉 IC 封測產業趨勢，並對市場需求充分掌握，使得本公司能夠配合客戶需求適時開發關鍵技術，有助於客戶訂單之爭取。

(2) 擁有先進製程技術

IC 封測業之國內外廠商競爭激烈，各廠商多以開發新穎之製程技術來降低成本，並以較低之價格進入市場，價格競爭遂為 IC 封測業主要競爭條件，故製程技術亦為重要競爭指標。本公司擁有先進封裝技術，在產品製程中不斷改善技術，提高生產效率，協助客戶降低營運成本；此外，本公司積極創新研發，與客戶共同開發新製程技術和新產品，並建立專利權發展平臺，而目前本公司已取得國內外 553 項專利權，並於 100 年獲得美國智財 (IP) 投資銀行 MDB Capital Group 肯定，評選為 Astrum Award Winner，顯示本公司所擁有之先進製程技術已為重要之競爭利基之一。

(3) 生產已達經濟規模，產能亦持續擴充

IC 封測廠商之大規模量產，可降低單位研發成本、設備採購、營運費用之單位成本，而本公司自 86 年成立以來，專注於封裝測試領域相關之技術與生產研發，目前已建構完整人員及設備機台，產能亦已達經濟規模，而工程師與生產線人員在製程與操作技術成熟，加上本公司有效管理設備機台且分散式之多樣化經營策略，使得生產效率大幅提升，單位成本相對降低。另本公司未來將密切掌握市場及客戶需求，持續產能擴充，以因應客戶多元化需求及降低單位成本，增加公司之市場競爭力。

(4) 封測一元化服務

本公司提供客戶記憶體 IC、LCD 驅動 IC、邏輯/混合訊號 IC 及晶圓凸塊製造等產品封裝及測試之一元化服務，滿足客戶一次購足之需求，並能縮短運送時間與節省運輸成本，間接為客戶節省營運成本，進而強化彼此競爭力，共同製造雙贏局面。

(5) 與客戶建立長期緊密夥伴關係

本公司提供核心技術產品全程製造之完整服務予客戶，在封裝測試技術、產品品質及交期服務均能滿足客戶的需求，並與客戶共同研究開發新產品及新製程技術，故本公司目前已獲得多家國內外 IC 大廠之認證肯定，而 IC 大廠基於技術保密、品質及長期合作默契考量，除非產品出現重大缺失，並不會輕易更換供應商，顯示本公司與客戶已建立長期緊密夥伴關係。此外，本公司除繼續與現有客戶維持良好關係，繼續或延長現有代工或產能保障合約外，未來將利用先進製程技術之基礎，致力於開發邏輯/混合訊號與消費性 IC 產品新客戶，有助於本公司未來的營運發展。

(6) 穩健之財務結構

大者恆大為封測業未來發展趨勢之一，本公司擁有充足之現金流及健全資產負債結構，能夠確保本公司持續穩健投資及發展，亦為 IC 產業不景氣時，維持營運穩定度之關鍵，因此穩健財務結構為本公司與客戶長期合作與共同成長之重要基礎，亦為本公司競爭利基之一。

(7) 具備完整之產品開發藍圖及多元之發展動力

本公司擁有產業經驗豐富之研發技術團隊，除了持續強化及改善 IC 封裝測試技術及品質外，為因應未來 IC 主流市場之需求，亦積極發展最先進的技術及服務（包含目前正投入開發之 12 吋晶圓細間距鍛線技術（Fine Pitch Bonding）、覆晶封裝技術（Flip Chip）、應用於晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）和重佈線（RDL）技術、堆疊式晶片封裝（Stacked-Die）、多晶片封裝（Multi-Chip）、系統級封裝（SiP）等高利潤封裝產品技術），故本公司憑藉多元化封測產品技術，搭配本身技術整合及開發能力，提供完整且符合市場及客戶需求之產品技術，不但降低 IC 產業不景氣之衝擊，亦提供客戶更多元化及差異化之封測服務，增加公司競爭優勢。

4. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 資本及技術密集高，進入門檻較高

半導體工業是資本與技術密集的工業，由於半導體測試所需之測試機台昂貴、IDM 委外代工訂單趨增及產品技術變化快速，需要投入之資本支出越發龐大。另半導體封裝之技術密集度高，其製程技術與產品產出良率決定生產成本高低，而研發人才與製程技術具有密切關係，但研發專業人才培養及延攬不易，加上封測產品需經過客戶認證後方能取得訂單，造成新競爭者有較高之進入門檻。本公司擁有優秀技術研發團隊，在產業深耕多年，實務經驗豐富，充分掌握半導體封裝趨勢與需求，且本公司已達經濟規模，產品製程技術亦取得國際大廠之信賴及品質認證，顯示本公司具有市場競爭力。

B. 國內半導體工業體系分工完整

台灣半導體專業分工體系發展多年，具備上下游產業鏈完整、專業分工配合度高、產業群聚效果顯著、週邊支援產業完善等優勢，且晶圓代工廠、封裝與測試廠均具有經濟規模、專業化之製造能力、彈性靈活的生產調度、世界級的服務品質與快速的應變能力等，符合產業趨勢需求，可提供高品質且具有國際競爭力之產品，對於未來發展將是一大利基。

C. 產品所屬產業及終端應用市場未來將持續成長

由於智慧型手機、平板電腦、Ultrabook、行動通訊、車用電子、AI 智慧等出貨量成長帶動相關晶片的封測訂單、IDM 廠委外代工趨勢持續、銅打線用量將受益於美國 Fabless 與日本 IDM 廠陸續下單而具成長空間、以及隨著 1x 奈米製程技術滲透率的提高，其對於先進封裝及打線封裝的需求皆將同步提升，有利於提升產業附加價值，帶動產業高值化的發展。另就終端應用之儲存設備業觀之，隨著智慧型手機及平板電腦等消費性電子產品之強勁需求，可望刺激 DRAM 及 NAND Flash 成長；而就顯示器終端應用產業觀之，雖然 LCD 監視器及個人電腦需求持續衰退，但在 LCD TV 需求增加下，預計全球大尺寸面板產值年增率將小幅上升為 3.2%，產值達 1,013 億美元，而在小尺寸面板方面，智慧型手機及平板電腦需求量保持平穩。綜上所述，本公司產品所屬產業及終端應用市場未來將持續成長，本公司未來成長空間相對可期。

D. 國際 IDM 大廠加速委外趨勢有利於封測市場

98 年金融風暴重創全球經濟與國內外 IT 產業下，國際 IDM 廠對於庫存調控更為謹慎，不再投資擴產，且削減資本支出並保守擴建後段 IC 封測產能，同時 IDM 廠修正營運模式（即 Fabless 或 Fab-Lite）及進行結構重整，專注於市場開發與研發，提升經營效率、降低自建晶圓廠的風險、集中資源及降低生產成本，致 IDM 廠持續提高委外代工比重，且在

半導體封裝型態隨 IC 製程精密化而走向高階封測技術趨勢下，IDM 廠高度依賴不斷投入研發新技術及因應各項新型態 IC 產品所需高階封裝技術的專業封測廠之情況下，國內 IC 封測廠接獲 IDM 大廠委外的商機將持續增加。

本公司擁有產業經驗豐富之研發技術團隊及先進製程技術（如：捲帶式薄膜覆晶封裝（COF）、玻璃覆晶（COG）及塑膠基板覆晶（COP）、晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）及微機電系統（MEMS）等封測產品之技術等），能夠配合客戶需求適時開發關鍵技術，並在產品製程中持續改良製程技術，提高生產效率，協助客戶降低營運成本；此外，本公司生產已達規模經濟，且視市場及客戶需求持續擴充產能，本公司適足之產能可滿足 IDM 大廠多元化需求且降低單位成本，進而增加價格競爭優勢，有助於 IDM 委外代工訂單之爭取。

(2) 不利因素與因應對策

A. 資本支出逐漸增加

本公司從事封裝測試服務，其所有測試機台成本高，且產品世代交替之下測試機台需定期投入資金做規格升級或是汰舊換新，加上封裝測試技術變化迅速，各家半導體大廠已陸續邁入更高階之製程，搭配之封裝技術難度亦同步提高，所需投入之資本支出越發龐大，因此資本支出金額增加將提高本公司投資風險。

因應對策：

本公司設有研發中心，與客戶共同研究開發封裝測試技術，隨時掌握市場需求，藉以瞭解其對未來新封裝測試技術之趨勢，以確保於正確且即時的時機推出符合市場及客戶需求之產品技術。此外，本公司審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術的規劃，並隨著市場需求適時調整設備組合，以期最小設備組合投資因應多元化之客戶需求，降低開發新封裝測試技術相關投資金額與風險，並追求有效率運用自由現金流，發揮最大經營效益。

B. 封裝測試技術變化快速，且本身較少主導權

伴隨終端應用產品擴展快速，記憶體應用領域與產品類別更為多元，而隨著市場提高對產品功能、效能、成本與外觀設計之要求，加上同業間激烈競爭，致半導體封裝測試技術變化迅速；此外，封裝測試新技術主導權在設計者及使用者，難以即時掌握市場對新技術之接受度。

因應對策：

本公司提供半導體後段全程製造之完整服務，其封裝測試產品需 IC 製造廠與封測廠之共同認證，IC 製造廠有鑑於產品技術保密性與品質穩定性之必要，會選擇適當的 IC 後段封測廠長期緊密合作，一旦確認供銷合作關係，即不易產生變動，加上本公司與客戶共同研究開發新產品技

術，確保於適切且即時的時機推出符合市場需求之產品技術；此外，本公司致力於核心技術之研發與創新，除了繼續與現有客戶維持良好關係外，亦持續開發邏輯/混合訊號與消費性 IC 產品等之封裝測試技術，以爭取具有潛力之新客源，進而分散其產品之風險。

C. IC 產品壽命週期縮短，致產業景氣波動明顯

本公司為 IC 設計公司、整合元件製造公司及 IC 晶圓廠提供記憶體 IC、LCD 驅動 IC 及邏輯/混合訊號產品之封裝測試服務，而 IC 封裝測試屬於 IC 後段生產步驟，其需求來自於 IC 產業，故 IC 產業景氣榮枯與其具有密切關係。

因應對策：

本公司擁有尖端之半導體後段全製程技術服務，積極開發高成長終端產品應用市場，除了持續改善在記憶體 IC 產品及 LCD 驅動 IC 產品之封裝測試技術與品質、縮短交期及隨時因應市場需求而調整產品組合外，本公司晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）及微機電系統（MEMS）等新製程產品已陸續通過客戶驗證，並積極建立覆晶封裝技術於邏輯/混合訊號產品之應用，故本公司藉由多元化產品線提供客戶更多元化之封測服務，降低景氣循環的風險；且本公司與現有客戶建立長期穩定夥伴關係，並積極開發邏輯/混合訊號產品之新客戶，使產能獲得充分而穩定之利用。另本公司藉由審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術的規劃，以彈性因應 IC 產業景氣繁榮時所帶來大量訂單以及不景氣時訂單減少之衝擊。此外，本公司維持穩健之財務結構，亦降低 IC 產業不景氣時對公司營運穩定度之不利影響。

D. 專業 IC 封測人才培養、招募及留任不易

由於 IC 封測相當重視研發團隊，具有豐富經驗及素質優良之研發人員為 IC 封測公司成功之關鍵因素，而隨著近幾年 IC 產業快速發展，對專業研發人員之需求日益增加，但培養及招募專業研發人員不易，致本公司亦將面臨專業研發人才短缺之不利因素。

因應對策：

本公司除透過內外部各項教育訓練制度，提升員工之專業技能，並提供各項福利措施，使員工能共享經營成果，凝聚向心力。目前本公司亦股票上市，使股票更具流通性，達到留任原有之專業研發人才的效果，並於招募研發人員時，更具有吸引力。

E. 原材料成本上漲

本公司封裝測試過程中之主要關鍵原料為導線架、基板、金線、IC 載板、樹脂等物料，所占比例約三成，故原物料價格上漲勢必對 IC 封測產業帶來衝擊，導致本公司對於原料成本及存貨之控管面臨更大的挑戰。

因應對策：

本公司除了充分掌握原物料變動之相關訊息，隨時注意其走勢變化外，並透過提出替代原材料、改良現有製程技術及研發先進製程技術等解決方案，提高產品良率，降低成本上漲之影響，以利本公司維持穩定獲利之競爭空間。

F. 大陸在地化生產要求

由於中美貿易戰以及美國相關法令導致大陸加速半導體自主生產計畫，112 年將會有更多產能增加導致價格開始下降，並且由於市場狀況下修以及庫存量增加，將會影響本公司獲利能力。

因應對策：

提供客戶更優質之品質與服務，持續加強技術研發能力及製程之改良，以提升生產效能、產品品質及降低生產成本，並致力於維持客戶滿意度，除積極維繫既有客戶長期合作關係外，亦戮力於開發其他新客戶，以鞏固、進一步強化市場地位。

G. 對等關稅的影響

美國川普總統開徵對等關稅，將對整體經濟環境產生衝擊。若關稅轉嫁到消費端，則可能造成終端需求下滑，影響景氣。若轉嫁到供應鏈，則造成供應鏈營運的壓力，影響獲利。

因應對策：

面對產業的變化與動盪，公司仍將保持穩健經營的步調前行，並專注於持續提高生產效率與彈性，以應對市場的變化與客戶的急單需求。持續改善成本，善用自動化取代簡易人力，並謹慎資本支出。持續推動核心技術的競爭優勢（如低成本凸塊與封裝解決方案），以提升主力產品的市佔率、進一步強化市場地位。

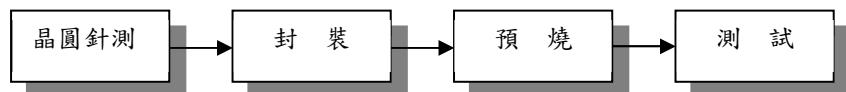
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之用途

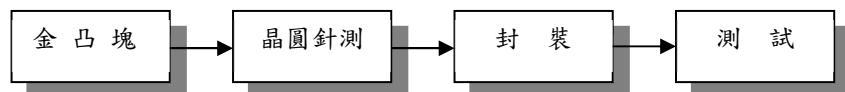
本公司主要的產品有多晶片封裝（Multi-Chip），超薄小型晶粒承載器積體電路（TSOP）、錫球陣列封裝（BGA）、DFN/QFN、捲帶式薄膜覆晶封裝（COF）、玻璃覆晶（COG）及塑膠基板覆晶（COP）等之封裝及測試代工和晶圓凸塊製造（Bumping）、晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）/覆晶封裝技術（Flip Chip）。經本公司提供整體性積體電路封裝與測試服務後，客戶的產品主要應用在車用、資訊、通訊、手機、穿戴及消費性電子等相關產品。

2. 產製過程

● 記憶體 IC 產品與邏輯/混合訊號 IC 產品



● LCD 驅動 IC



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料有金鹽（氯化金鉀）、基板（Substrate）、金線（Gold Wire）、導線架（Lead Frame）、樹脂（Molding Compound）等供應廠商皆屬國內外知名大廠，貨源穩定、品質優良；且本公司對主要原料供應商實施不定期的品質稽核，以期獲得更良好品質的貨源供應。持續與供應商強化合作關係，以維持材料供給之穩定性。

主要原料	供應商名稱	國內	國外	供應狀況
金鹽	光洋應材	V		良好
	Metalor		V	良好
基板	Ryowa		V	良好
	欣興電子	V		良好
	景碩科技	V		良好
	禮鼎科技	V		良好
	日月光	V		良好
金線	Tanaka		V	良好
	MKE		V	良好
導線架	SHINKO		V	良好
	長華電材	V		良好
	復盛集團	V		良好
	HDS		V	良好
樹脂	ShowaDenko		V	良好
	Kyocera		V	良好
	長華電材	V		良好

(四) 最近二年度任一年度曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例及增減變動原因

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度			113 年度			114 年度截至前一季止（註）					
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率（%）	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率（%）	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率（%）	與發行人之關係
1 台灣銀行	1,737,930	35.63	無	台灣銀行	2,547,692	40.09	無	—	—	—	—	—
其他	3,140,405	64.37		其他	3,806,885	59.91		—	—	—	—	—
進貨淨額	4,878,335	100.00		進貨淨額	6,354,577	100.00		—	—	—	—	—

註：截至年報刊印日止，最近期114年3月31日之合併財務報告尚未經董事會通過及會計師核閱。

進貨增減變動原因：係因市場趨勢變化與客戶產品需求變動。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度			113 年度			114 年度截至前一季止（註）					
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率（%）	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率（%）	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率（%）	與發行人之關係
1 客戶 A	5,251,529	24.59	無	客戶 A	5,376,979	23.69	無	—	—	—	—	—
2 客戶 B	2,834,188	13.27	無	客戶 B	2,604,235	11.47	無	—	—	—	—	—
3 客戶 K	1,787,471	8.37	無	客戶 K	2,487,062	10.96	無					
其他	11,483,040	53.77		其他	12,227,633	53.88		—	—	—	—	—
銷貨淨額	21,356,228	100.00		銷貨淨額	22,695,909	100.00		—	—	—	—	—

註：截至年報刊印日止，最近期114年3月31日之合併財務報告尚未經董事會通過及會計師核閱。

銷貨增減變動原因：主係隨客戶市佔率變化而異。

三、從業員工現況

最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

114 年 3 月 31 日

員工 人數 (人)	年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
	直接人員	工程類			
	直接人員	2,846	3,227	3,133	
	工程類	2,213	2,332	2,269	
	管理類	330	331	321	
	合計	5,389	5,890	5,723	
	平均年歲	39	38.7	38.9	

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
平均服務年資 (年)		10.5	10.1	10.4
學歷 分布 比率 (%)	博士	0.1	0.1	0.1
	碩士	8.8	8.5	8.4
	大專	68.2	70.4	70.6
	高中	22.5	20.6	20.5
	高中以下	0.4	0.4	0.4

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因汙染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司悉依勞動基準法、勞工保險條例、職工福利條例及相關法令辦理員工相關福利，並辦理員工定期健康檢查、在職教育訓練及免費團體保險服務。

1. 員工福利措施：

- (1) 員工自到職日起，即享有勞工保險、全民健康保險及團體保險。
- (2) 提供交通車及員工宿舍照顧外地員工。
- (3) 推動特約商店給予員工優惠，並積極開發幼兒園、托嬰中心特約商家，以提供員工安置幼兒的照護資源。
- (4) 生日禮券、三節禮券、婚喪喜慶賀奠金及生育津貼之各項補助。
- (5) 舉辦名人講座、電影包場、家庭日等福利活動，成立多元社團活動，並讓員工兼顧工作與生活平衡。
- (6) 舉辦部門聯誼活動以加強各部門之交流。

2. 員工之進修及訓練：

- (1) 內部教育訓練：提供領導管理類、工作效能類、工程技術類、新進員工類、品質管理類與環安工衛類，總計六大類課程。
- (2) 外部進修：鼓勵員工提升工作能力，提供外訓補助。
- (3) 自主學習資源：透過數位訓練學習平台，提供員工豐富的線上課程資源；同時也發送主題電子報，例：英文、簡報、Excel、AI 等，讓員工有隨時學習的機會。

3. 退休制度與其實施情形：

公司為員工設置退休金計劃，依勞工退休金條例選擇新制人員，公司按員工每月薪資 6% 提撥退休金存入勞保局勞工個人帳戶；另對有舊制資格員工，公司按員工每月薪資總額一定比率提撥退休準備金存入台灣銀行，並設置退休金監督委員會，及每年特聘專業顧問進行退休金精算，以確保員工權益。另於每年年度終了前，估算勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。

4. 勞資雙向溝通：

公司定期進行新人訪談、員工勞資會議、福委會會議、移工月會、產線會議等雙向會議傳遞重要訊息與政策，還同時提供電子/實體意見箱等全天候溝通平台來收集，了解並解決員工的疑難，建立勞資雙方共同參與及充分溝通的環境。

5. 員工健康促進及照護：

- (1) 每年實施優於法規的年度健康檢查項目，並有醫師駐診服務，適時給予同仁健康醫療專業的諮詢建議。
- (2) 強化哺育同仁照護，設置舒適的集乳室。
- (3) 於公司內建置按摩室，配有視障按摩師，照顧同仁身體健康的同时亦提供視障者穩定的就業機會。
- (4) 定期推動健康促進活動及健康知識的宣導，鼓勵員工建立健康的生活型態，
例：今年度舉辦健走活動，活動總距離達 113,797 公里，同仁共減下 121 公
斤且達 4 成人員血壓下降，有效防治員工肥胖及三高等慢性疾病。

6. 職場多元化與平等

公司積極打造平等與尊重的職場環境，女性員工人數佔比約為 55%、女性主管佔比約為 20%，顯示選才無關性別，尊重專業並提供工作保障。未來將持續關注女性員工議題，持續優化相關福利制度，持續發揮個人價值並與公司共同成長。

- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、 資通安全及智慧財產權管理

(一) 資通安全管理

1. 資通安全風險管理架構

資訊技術單位每年針對財務面、策略面、營運面及災害面，透過辨識、分析、評價程序鑑別資訊安全風險。並對潛在風險的發生頻率、衝擊程度與控制程度進行量化評估。持續監控風險與提出因應對策。

2. 資通安全政策

- (1) 保護公司資訊資產之機密性，避免未經過授權的存取或不當的外洩。
- (2) 確保資訊作業之完整性，避免不當之竄改、破壞等情事。
- (3) 確保被授權的使用者在需要時，可以使用資訊資產。

3. 具體管理方案

- (1) 重要資產盤點與風險評鑑。
- (2) 文件合規審查及適切性調整。
- (3) 重要系統之營運衝擊分析與災難復原演練。
- (4) 強化員工資安意識與能力。
- (5) 穩固資安防護的工作環境。
- (6) 嚴格管控資安供應鏈之服務品質。
- (7) 積極尋求外部資源以擴展資安防護面向。

4. 投入資通安全管理之資源：

本公司對於資訊安全之重視，已為公司及全體同仁共同意識，於 113 年具體投入的資通安全管理做法及效益如下：

- (1) 資安專責人力：本公司設有「資訊安全室」，負責推動、協調、監督及審查資通安全管理事項。
- (2) 認證：通過 ISO 27001 年度驗證，無重大資安缺失。
- (3) 資安事件：113 年無重大資安事件影響公司營運。
- (4) 教育訓練：進行 6 次郵件釣魚詐騙信件演練及 25 次主題式資安社交工程宣導，完成教育訓練之人員共計 4,161 人次。
- (5) 災難復原演練：完成 43 場次資訊系統演練，完成率 100%。

5. 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。

(二) 智慧財產管理計畫

1. 本公司擬定結合公司營運目標與研發方向的智慧財產管理政策，成立智權管理專責單位負責建置智慧財產管理相關辦法，以確保智慧財產保護之落實與執行品質，同時強化公司競爭優勢。為了鼓勵員工提升創新實力、累積公司智權能量，智權管理專責單位不定期分享智慧財產相關資訊以深耕智權觀念，同時制定了「發明提案獎金管理辦法」並導入電子化「智權管理系統」，讓員工能有效率的掌握智權訊息、落實智權管理。

2. 113 年執行情形（董事會報告日期：113 年 11 月 5 日）

- (1) 本公司積極推動智慧財產管理計畫、建立智權管理系統及資料庫並持續更新，同時導入專利申請審查及價值檢視機制，以強化公司的智慧財產權品質。
- (2) 本公司之智慧財產管理人員已取得 TIPS (Taiwan Intellectual Property Management System) 自評員評鑑資格，以落實智慧財產管理計劃

(3) 目前取得智慧財產權成果如下：

A. 截至 113 年 12 月 31 日止，本公司於全球專利有效件數已累積至 553 件、申請中專利件數為 87 件、已註冊商標件數為 53 件。

智慧財產權		台灣	中國	美國	其他	件數
專利	有效專利件數	301	160	87	5	553
	申請中件數	14	73	0	0	87
商標	已註冊件數	10	14	8	21	53

B. 105 年獲得國家發明獎。

C. 100 年獲得美國智財 (IP) 投資銀行 MDB Capital Group 肯定，評選為 Astrum Award Winner。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
委託加工承攬合約書	A 公司	113/01/01 至 119/12/31	提供晶圓/積體電路加工服務	1. 成品良率約定 2. 智財權侵害賠償條款
積體電路委外加工承攬契約	K 公司	110/01/01 至 115/12/31，得自動延展或依合約條款終止	提供加工裝配、可靠性試驗、擦蓋印、加工測試之服務	1. 瑕疵擔保約定 2. 智財權侵害賠償條款 3. 賠償責任限制約定
服務承諾保證書	C 集團	105/01/01 至 107/12/31，得自動延展或依合約條款終止	提供晶圓加工服務	1. 成品良率約定 2. 智財權侵害賠償條款
積體電路加工裝配契約	M 公司	自 99/01/01 生效，得自動延展或依合約條款終止	提供積體電路加工裝配服務	1. 成品良率約定 2. 智財權侵害賠償條款
積體電路封裝及測試加工承攬契約	G 集團	113/07/01 至 115/06/30，得自動延展或依合約條款終止	提供積體電路加工封裝及測試服務	1. 成品良率約定 2. 智財權侵害賠償條款
Service Agreement	U 公司	102/07/01 起有效，得依合約條款終止	提供積體電路封裝測試服務	1. 成品良率、品質約定 2. 智財權侵害賠償條款
加工合同	Y 集團	110/10/01 至 113/09/30，得自動延展或依合約條款終止	提供積體電路封裝測試服務	1. 成品良率、品質約定 2. 智財權侵害賠償條款
委託加工契約	F 集團	113/01/01 至 116/12/31，得自動延展或依合約條款終止	提供積體電路封裝測試服務	1. 成品良率、品質約定 2. 智財權侵害賠償條款
Contract Assembly Agreement	I 集團	自 96/11/13 生效，得依合約條款終止	提供晶圓封裝服務	1. 成品良率、品質約定 2. 智財權侵害賠償條款

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
土地租賃契約書	南部科學工業園區管理局	103/07/01 至 113/06/30	向南部科學工業園區管理局承租土地	1.懲罰性違約金約定 2.租金約定 3.提前終止約定
土地租賃契約書	南部科學工業園區管理局	101/04/03 至 121/04/02	向南部科學工業園區管理局承租土地	1.懲罰性違約金約定 2.租金約定 3.提前終止約定
土地租賃契約書	新竹科學工業園區管理局	97/09/18 至 116/12/31	向新竹科學工業園區管理局承租土地	1.懲罰性違約金約定 2.租金、連帶債務約定 3.提前終止約定
土地租賃契約書	新竹科學工業園區管理局	103/08/01 至 123/07/31	向新竹科學工業園區管理局承租土地	1.懲罰性違約金約定 2.租金、連帶債務約定 3.提前終止約定
Supply Agreement	Ryowa Co., Ltd.	103/09/01 至 108/08/31，得自動延展或依合約條款終止	供應積體電路封裝業務所需材料	1.付款條件 2.擔保及責任約款

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析（合併財務報表）

單位：新台幣仟元；%

項目	年度	113 年	112 年	差異	
				金額	%
流動資產		23,643,516	25,160,658	(1,517,142)	(6.03)
不動產、廠房及設備		19,996,760	19,139,503	857,257	4.48
其他資產		1,739,576	1,860,323	(120,747)	(6.49)
資產總額		45,379,852	46,160,484	(780,632)	(1.69)
流動負債		8,673,445	7,353,218	1,320,227	17.95
非流動負債		11,632,173	13,953,614	(2,321,441)	(16.64)
負債總額		20,305,618	21,306,832	(1,001,214)	(4.70)
股本		7,272,401	7,272,401	—	—
資本公積		6,064,637	6,064,637	—	—
保留盈餘		11,622,494	11,463,406	159,088	1.39
其他權益		114,702	53,208	61,494	115.57
歸屬於母公司業主之權益總額		25,074,234	24,853,652	220,582	0.89
增減比例變動達 20%以上者之分析說明：					
其他權益增加：主係本年度匯率變動致國外營運機構財務報表換算之兌換利得增加及去年度本公司經董事會決議通過授權子公司處分其採用權益法投資之股權，於本年度完成股權處分移轉程序，將轉列為與待出售非流動資產直接相關之權益除帳所致。					

二、財務績效分析（合併財務報表）

(一)經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元；%

項目	年度	113 年	112 年	差異	
				金額	%
營業收入		22,695,909	21,356,228	1,339,681	6.27
營業成本		(19,751,813)	(17,806,803)	(1,945,010)	10.92
營業毛利		2,944,096	3,549,425	(605,329)	(17.05)
營業費用		(1,770,051)	(1,726,916)	(43,135)	2.50
其他收益及費損淨額		99,892	85,943	13,949	16.23
營業利益		1,273,937	1,908,452	(634,515)	(33.25)
營業外收入及支出		373,116	359,774	13,342	3.71
稅前淨利		1,647,053	2,268,226	(621,173)	(27.39)
所得稅費用		(227,058)	(374,798)	147,740	(39.42)
本期淨利		1,419,995	1,893,428	(473,433)	(25.00)
其他綜合損益（稅後淨額）		109,619	(179,057)	288,676	(161.22)
本期綜合損益總額		1,529,614	1,714,371	(184,757)	(10.78)
增減比例變動達 20%以上者之分析說明：					
1. 营業利益、稅前淨利、所得稅費用及本期淨利減少：主係本年度產品組合差異、主要原物料價格上漲及電費費率調漲，使營業成本增加，營業毛利減少所致。					
2. 其他綜合損益增加：主係本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失減少及本年度完成股權處分移轉程序之與待出售非流動資產直接相關之權益除帳所致。					

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

請參閱壹、致股東報告書。

三、現金流量分析（合併財務報表）

(一)最近年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	全年來自 營業活動淨 現金流量	全年因投資 活動淨現金 流量	全年因籌資 活動淨現金 流量	全年因匯率 變動對現金 及約當現金 之影響	現金剩餘 數額	現金不足額 之補救措施	
						投資 計畫	融資 計畫
12,354,035	5,940,582	(615,105)	(2,475,391)	14,918	15,219,039	—	—
本年度現金流量變動分析：							
營業活動：主係包含稅後淨利及折舊費用。							
投資活動：主係用於資本支出及部分因處分待出售非流動資產而抵銷。							
籌資活動：主係發放現金股利及淨償還銀行借款。							

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業活 動淨現金流量	全年現金 流出量	現金剩餘 數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
15,219,039	5,440,050	8,166,173	12,492,916	—	—

1. 該年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動\$5,440,050：主係預計產生營業利益。
- (2) 投資活動 (\$4,366,984)：主係購置營業用設備。
- (3) 融資活動 (\$3,799,189)：主係償還銀行借款及發放現金股利。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響（合併財務報表）

重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之資金來源	所需資金 實際總額	實際或預定資金運用情形	
			113 年	114 年
廠房及設備	自有資金或銀行借款	8,842,384	5,451,431	3,390,953

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司及子公司最近年度採權益法之轉投資皆著眼於長期策略性目的，並以提升國際市場競爭力為主要考量，對每一投資案皆經審慎評估後為之。本公司及子公司 113 年度認列採用權益法之投資利益為新台幣 2,683 仟元，較上一年度減少新台幣 217,208 仟元，主係本公司於 112 年 12 月 21 日經董事會決議通過授權 100% 持有之子公司 ChipMOS TECHNOLOGIES (BVI) LTD. 處分其採用權益法之投資宏茂微電子（上海）有限公司全數 45.0242% 股權，並將其轉列為待出售非流動資產及停止採用權益法，故 113 年度並無認列對宏茂微電子（上海）有限公司採用權益法之投資利益所致。

六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動

本公司及子公司之借款，主要為支應營運活動所需。借款條件較佳且受利率變動影響較小為借款時主要考量因素。財務單位隨時注意利率變化、與銀行保持密切聯繫、定期評估借款利率與市場平均利率的差異，並相應地執行必要的調整，以降低利率變動對損益所造成之影響。

2. 匯率變動

本公司及子公司外幣計價之銷貨係以美元為主，而主要原物料及機器設備的部分付款為美元或日幣計價，故兩者間可部份沖銷，達成自然避險的效果。

惟外幣在轉換成台幣時，仍會產生匯兌損益，故匯率變動對本公司營收及獲利有其影響。

本公司及子公司避險策略採用自然避險為主，以降低外幣曝險部位，且財務單位隨時關注國際匯率變動，並蒐集相關匯率資訊，預作匯兌的規劃，以降低兌換營運資金所導致的匯兌損失。

3. 通貨膨脹

通貨膨脹影響層面之鉅，本公司隨時關注國際經濟情勢之變化，以及可能引發通貨膨脹異常升溫之因素，以預警原物料市場價格之波動及持續尋求替代性材料作為決策及檢討之依據。並與供應商及客戶保持良好之互動關係，以降低因市場供需波動造成價格變化而產生對成本或營收變動之影響。本公司因製程之需，在貴金屬的需求佔成本一定比例，對於加工貴金屬的供應鏈完善建立，以更具彈性地因應貴金屬價格波動造成損失之風險。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司及子公司並無從事高風險、高槓桿之投資，僅從事降低公司既有及未來外幣資產與負債部位之潛在風險之財務規劃，且皆在公司可控制之範圍內，每筆金融交易皆依本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」之衍生性商品交易規定暨「財務作業授權及核准權限表」辦理。

截至年報刊印日止，本公司及子公司並無資金貸與他人亦無為他人背書保證之情事，惟配合本公司營運所需之海關關稅背書保證餘額為新台幣 59,800 仟元。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 未來研發計畫

本公司及子公司一直本著「研發為本」的精神，針對封測本業之先期性研究開發以及量產性問題排解，無論是結構、材料、電性等相關領域，在每年的研發議題上多有著墨，以提供客戶全方位的資訊。由於 3C 產品必須具備輕、薄、短、小需求的行動平台和普及度橫跨不同應用的電子產品，如觸控面板控制 IC、電源管理 IC、微機電 IC、生物特徵辨識器（如指紋辨識 IC）等，所以更先進的多晶片封裝技術已然成為基本配備，達成更全面性的整合。

由於封測廠必須搭配最新的研發技術可提供顧客有效解決方案以保持市場競爭力。因此本公司及子公司仍持續加強核心技術投資，朝向先進封裝測試相關技術研發。這十多年來投入研發的心力有目共睹，歸功於工程人員專業的技能及歷年來所累積的經驗、現有材料的改善及新材料的評估，現有設備使用之改良及新規格設備的評估，以降低生產成本，同時與產、學、研共同研發下一世代先進之封裝與測試技術。放眼未來，本公司及子公司以更積極的研發能量，來配合客戶技術發展及新產品開發，亦可厚植深耕本公司及子公司研發實力，開拓新商機的發展契機，以此自許為封測業的領導者。

2. 計畫開發之新商品（服務）項目

本公司及子公司未來除了持續增加高階記憶體之封裝測試服務產能外，亦將擴充及增加下列產品之封裝測試技術能量與產能：

- A. 開發銀合金凸塊製程於顯示驅動 IC 應用。
- B. 開發應用於記憶體產品的 1M1P 重佈線（RDL）結構。
- C. 開發應用於 Micro-LED TV 顯示器的雙層覆晶薄膜（COF）雙晶片技術。
- D. 開發應用於覆晶薄膜軟板封裝（COF）的非矩形金凸塊製程技術。
- E. 開發覆晶與打線製程混合鍵合封裝技術。
- F. 開發具散熱片之覆晶晶片尺寸級封裝。

3. 預計投入研發費用

本公司及子公司預計投入研發費用金額係依新產品及新技術開發進度逐步編列，並視未來營運狀況維持一定幅度之成長，以確保本公司及子公司之競爭優勢，而 114 年度預計投入之研發費用約佔 114 年度全年營收的 5%。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司近年來並無因國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務及業務之情事，然因本公司及子公司之制度規章皆依相關法令訂定，並據以執行，如相關法令有所修正時，本公司及子公司亦即時依法令修正並更新相關之制度規章。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司所屬之產業，產品與技術交替迅速，除需不斷引進先進製程技術外，亦需強化上下游供應鏈之策略聯盟合作關係。當致力於先進製程技術之取得與開發，並與重要之材料供應商與客戶取得策略合作聯盟，同時強化行銷管道，以使產品及客戶朝多元化之發展。財務運作上，針對產業之特性加強現金流量之管理，維持適當財務結構，分散經營風險。

面對科技改變所帶來的資安風險，本公司已於 103 年起制定資訊安全政策（Information Security Policy），並藉由 ISO/IEC 27001:2013 國際標準資訊安全管理系統，14 個管理領域建立資訊中心資訊安全管理框架，設立資訊安全管理委員會及資安意見信箱，並依照金管會規定，於 111 年設置資訊安全專責單位。本公司亦遵照「上市上櫃公司資通安全管控制指引」，制定資訊安全相關管理程序書作業規範，規劃組織內部的資安相關管理活動，並對於公司內部資訊安全相關風險評估與需求進行協助。每年也持續透過內部稽核活動以及辦理外部第三方驗證，來檢視資訊中心資安相關控制目標與控制措施是否落實，本公司於 106 年全廠區通過 ISO/IEC 27001 認證取得證書。因應未來 ISMS 改版需求，本公司聘用顧問進行改版輔導作業，重新審查改版需求，進行內部流程及新版程序書修訂討論，已於 113 年順利達成 ISMS 新版認證。

持續針對重要資訊系統建立備援架構並進行災難復原演練，測試資訊系統復原時間目標（RTO）能在最大容許停機時間（MTPD）內完成，降低災害可能造成的生產中斷時間或財物損失降低。113年資訊中心對於重要資訊系統及服務分別完成43場演練活動，計有資料庫、生產系統主機、網路專線、骨幹核心交換器、Firewall等類型資訊資產，並將備援演練方式標準化以讓不同的廠區、不同的管理者維運中，可得到相同的預期備援效果。

為掌握可能的資安威脅與弱點資訊，本公司透過參與科學園區資安資訊分享與分析中心（SP-ISAC）加入會員，運用所提供的資安情資分析服務、訂閱弱點通報，以及提報資安異常事件取得專業資安診斷支援，對於資訊單位在緊急處理分析及回應資安事件上獲得不小的助益。另外，積極參與各類研討會，例如台灣資安大會，從各項主題吸取新知、反思現況、規劃更好資安環境。對於網路安全風險控管除了持續運用資安設備強化阻隔以及入侵偵測深入分析異常網路行為，每年亦透過資訊資產盤點掌握資產清單與資產價值，分析資產可能受到的威脅風險，給與重要資產對應防護等級規劃。因應電子郵件釣魚、變臉詐騙有增加趨勢，防護面亦增加信件過濾，並透過郵件社交工程演練服務，測試與提升內部人員對於郵件攻擊的警覺性，以預防網路攻擊，遠離惡意程式危害。為提升帳號管理，完成了導入特權帳號管理與雙因子認證。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司及子公司之組織因已健全運作並遵守相關法令之規定，以維持良好之企業形象，截至目前為止，尚無發生影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司廠房之規劃係以填滿現有產能及有效利用為前提，並考量客戶及市場實際需求之必要性。本公司及子公司廠房之擴充皆經完整、審慎與專責單位之評估過程，已充分考量投資回收效益及可能風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨方面

本公司適時針對主要進貨供應商進行營運及財務狀況評估，主要原料之採購除向客戶認證通過或指定之供應商進貨外，均維持兩家以上供應商，且供應廠商皆屬國內外知名大廠，並維持長期往來之合作關係，以確保進貨供應之穩定性，同時開發其他可能替代之材料與廠商，以增加進貨來源之彈性。

2. 銷貨方面

本公司已深耕半導體後段封裝測試服務領域多年，主要業務為提供中、高頻、高密度記憶體產品、液晶顯示器驅動與控制 IC、車用 IC 及行動穿戴 IC 等產品之封裝及測試服務，為國內第二大液晶顯示器驅動 IC 封測廠。主要客戶包括國內外半導體設計公司、整合元件廠及半導體晶圓廠等，本公司前十大銷貨客戶於 111～113 年度占各該年度營收淨額之比率分別為 81.3%、81.9% 及 82.3%，各期前十大銷貨客戶均十分穩定，並無對單一客戶或單一集團銷貨比重達三成以上之情形，故本公司銷售之對象，尚無過度集中之情事。此外，本公司除持續以優良之服務品質以提供客戶完善之解決方案及技術支援外，並與現有客戶維持長期良好合作關係，並積極致力於邏輯/混合訊號與消費性 IC 產品之新客戶開發，以將銷售集中風險降至最低。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，訴訟或非訟事件

1. 公司最近年度及截至年報刊印日止，已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。
2. 公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止，已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施

因為氣候變遷或系統性區域地質變化造成的破壞性地震、自然災害與極端天氣等災難性事件發生的頻率和影響的嚴重度已逐漸增加。本公司進行製造和其他營運的地點面臨自然災害風險，其可能影響本公司的運作，例如洪水、地震、海嘯、颱風和乾旱等可能造成公用事業供應中斷或短缺，如水和電。此外，本公司的供應商和客戶亦在相同區域進行營運。例如本公司的生產設施及營運、許多供應商、客戶以及半導體製造的原材料與設備供應商均位於台灣和日本，易受到地震、海嘯、洪水、颱風和乾旱影響，亦可能受到電力和水供應短缺或中斷的影響。

因此，如果一次或多次自然災害、公用事業的供應短缺或中斷（例如由非核政策引起的供電短缺）導致本公司、其客戶或供應商的營運長期中斷、或本公司的任何工廠或供應商設施因爆炸或火災而損壞或停止營運，均可能會降低本公司的產能並導致失去重要客戶，並對本公司的營運及財務績效產生潛在不利重大影響。此外，受到台灣電力公司供電服務或同一電網饋線的其他用戶的影響，本公司的生產營運偶爾面臨供電短缺或中斷風險。

本公司致力於維護完整的風險管理系統以保護自然資源與保障人員及資產的安全，並針對所有可能的緊急狀況及天然災害，就風險預防、緊急應變、危機管理及營運持續等方面，發展出全方位對應計劃及流程。本公司所有廠區均已取得環境管理系統（ISO 14001）及職業安全衛生管理系統（OHSAS 18001）的驗證。

本公司極為關注各類災害的緊急應變，例如颱風、氣候變遷引起的水患或乾旱、地震、傳染性疾病（如 H1N1 新型流感、新型冠狀病毒、COVID-19 等），以及水、電及公共設施供應中斷等。針對台灣所發生的地震對本公司的營運影響，本公司亦持續進行一系列的改善，包括強化地震緊急應變演練、改善生產機台設備防震固定及隔震措施以及提升受損機台與生產復原能力。除了維持各項風險預防與保護系統外，本公司也有火災與損失保險。即便如此，本公司的風險管理與保險仍可能無法涵蓋所有潛在損失。若任何一廠區或供應商之設備因火災或環境事件而導致損害或停工，將導致公司產能減少並影響本公司的財務績效。因此，本公司除了定期舉辦消防系統檢查與消防演習外，也進行全公司火災風險降低計劃，著重管理與硬體改善。

此外，在現今極度全球互動頻繁的時代中，便利的交通與頻繁的交流，使得各類傳染性疾病的疫情快速的漫延。由於相關的封鎖措施與疫情的關係，可能導致物流的延遲或受阻，造成原物料供應延遲或供應中斷的風險，也可能出現員工健康安全防護不足、造成生產受阻等風險。我們可能會在我們無法控制的範圍內發生與此類事件有關的費用或延誤，這可能會對我們的業務，經營成果和財務狀況造成重大不利影響。本公司已擬訂疫情整備與應變計畫並設置應變小組，以確保員工的健康與生產線的正常運作。同時，在生產所需的主要原物料方面，皆備有足夠的存量，也依據供應廠商所在地區的疫情狀況，進行適度的防範應變方案，增加安全庫存量或建立第二供應來源等，以降低原物料供應中斷的風險。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 最近年度關係企業合併營業報告書

本公司 113 年度關係企業合併營業報告書請參閱公開資訊觀測站 > 單一公司 > 電子
文 件 下 載 > 關 係 企 業 三 書 表 專 區
(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

(二) 關係企業合併財務報表：

請參閱本公司 113 年度合併財務報告第 4 頁，關係企業合併財務報表聲明書。

(三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

南茂科技股份有限公司



董事長：鄭世杰





ChipMOS